

業 務

概覽

關於我們

我們是「存儲+計算+模擬」芯片提供商，我們的產品廣泛應用於汽車電子、工業醫療應用，以及AIoT及智能安防設備。

我們經營模式為無晶圓廠模式，據此，我們聚焦芯片的研發與設計，同時與領先晶圓廠及封測代工公司展開合作，以確保業務可擴展性。通過內生增長與戰略收購，我們成為一家擁有全面產品組合的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，我們在全球範圍的關鍵市場佔據領先地位，持續賦能汽車電子、端側計算等科技前沿領域的發展與創新。具體而言，以2025年收入計：

- **利基型DRAM**：在DRAM產品中，我們專注於專為對性能、可靠性或工作環境有特定要求的應用領域而設計的利基型**DRAM**，而不是大規模生產的標準型**DRAM**。我們排名全球第七，於總部位於中國大陸的公司中排名第二。
- **SRAM**：我們排名全球第二，於總部位於中國大陸的公司中排名第一。
- **NOR Flash**：我們的Flash存儲芯片產品線包括**NOR Flash**及**NAND Flash**。**NOR Flash**經過優化以適用於快速、可靠的代碼執行。我們排名全球第七，於總部位於中國大陸的公司中排名第三。
- **IP-Cam SoC**：我們的智能視覺**SoC**產品線主要包括**IP-Cam SoC**、圖像信號處理器（「**ISP**」）及網絡視頻錄像機（「**NVR**」）**SoC**，而**IP-Cam SoC**集成**ISP**、視頻編碼等關鍵功能，以為網絡攝像機提供一體化算力。我們在全球**IP-Cam SoC**供應商中排名第二。

我們的業務方針

我們提供結合芯片、硬件、軟件、工具鏈及算法的產品，以服務多種應用場景。我們業務方針的核心是涵蓋三大產品線的全面產品組合：存儲、計算及模擬芯片。

存儲。我們面向汽車電子及工業醫療領域提供一系列**DRAM**、**SRAM**及**Flash**等存儲芯片。我們的存儲芯片能夠滿足嚴苛環境下對穩定性和耐用性的嚴格要求。

計算。通過長期的研發投入，我們已構建嵌入式**CPU**、視頻處理單元(**VPU**)、圖像信號處理(**ISP**)、神經網絡處理單元(**NPU**)及多項其他技術等廣泛的核心計算技術，以加強搭載我們計算芯片的終端產品的AI功能。這些能力奠定了我們的**SoC**產品線的基礎，該等產品廣泛應用於AIoT及安防等領域。

模擬。我們主要為汽車電子、工業及家電提供**LED**驅動芯片及其他**Combo**芯片。

業 務

我們的產品

存儲芯片

我們專注於DRAM、SRAM、NOR Flash及NAND Flash。我們的存儲芯片容量和帶寬廣，滿足各種嚴格要求，例如(i)在極端環境下穩定工作；(ii)低功耗；及(iii)長壽命。因此，我們的存儲芯片廣泛應用於汽車電子及工業醫療等行業。

我們的存儲芯片獲全球主要Tier 1汽車供應商廣泛採用及認可。於往績記錄期間，我們的汽車電子芯片出貨量逾10億顆。

在此成就基礎上，我們也致力於開發3D DRAM等新興存儲技術。

計算芯片

我們提供涵蓋核心計算技術的三個品類：智能視覺SoC、嵌入式MPU及AI-MCU。該等產品廣泛應用於端側計算場景，包括AIoT及安防以及其他嵌入式應用，例如二維碼／條形碼識別、顯控及打印機。我們的智能視覺SoC亦支持4K視頻編碼與計算加速。

模擬芯片

我們利用我們的汽車LED驅動及燈效控制能力提供模擬芯片。我們的產品組合包括線性驅動、DC-DC驅動、矩陣驅動、電源管理芯片、氛圍燈驅動及RGB驅動。

我們的LED驅動芯片廣泛應用於汽車外部照明（包括前大燈、行車燈、轉向燈、尾燈、剎車燈及倒車燈）與內部應用（例如氛圍燈及閱讀燈）。

此外，我們集成MCU、LED驅動、傳感及連接技術以交付Combo芯片，滿足汽車電子、工業及家電不斷變化的需求。

我們的市場機遇

AI技術的發展令我們的主要市場汽車電子及端側AI設備的應用更為廣泛。該趨勢正擴大對我們的存儲、計算及模擬芯片產品組合的需求並創造明確的產品市場機遇。

汽車電子

根據弗若斯特沙利文的資料，汽車行業正加速向電動化、智能化、網聯化演進。該等趨勢正改變車規級芯片的需求結構，為存儲及模擬芯片產品線的增長帶來強勁動能。

業 務

汽車電子的數據洪流推動存儲芯片容量與帶寬雙重升級。L3級及以上車型需實時處理激光雷達、多攝像頭等傳感器輸入，單車存儲容量從傳統車型的8GB躍升至200GB或以上，且要求-40°C至125°C寬溫域運行、10年以上數據可靠性。域控制器的集中式架構普及，進一步拉動LPDDR4、車規級NAND Flash等高速存儲芯片需求。該等動態拓展了我們車規級DRAM、SRAM、NOR Flash及NAND Flash產品組合的設計導入機會。

對模擬芯片的需求隨車輛電動化的普及而增加。座艙興起帶動對LED驅動芯片向高精度調光（16位PWM）、多通道（4路RGB+W）演進的需求。車規級接口芯片需支持ISO 15118充電協議與10Mbps傳輸速率，適配快充場景，契合我們的汽車LED驅動器、接口及電源管理芯片產品。

我們深耕車規級芯片行業逾20年，建立了全面質量管理體系及廣泛客戶支持網絡。我們的產品設計達到嚴格的车規級標準，廣泛應用於動力總成控制、安全、驅動程序信息、座艙娛樂及燈控等關鍵電氣及電子系統。該能力支持我們汽車存儲及模擬芯片產品實現更高的中標率及生命週期價值。

我們在車規級DRAM、SRAM及NOR Flash市場地位穩固。我們的LPDDR4產品以高帶寬、低功耗尤為適配自動駕駛域控制器，異步SRAM憑藉訪問速度成為激光雷達緩存優選。我們正在開發的車規級3D NAND Flash，致力於滿足國內市場對高端車規NAND產品的需求。此外，我們具備差異化功能的車規級LED驅動芯片豐富品類為我們帶來競爭優勢。

端側AI

2025年標志著端側AI市場大幅增長的開端。根據弗若斯特沙利文的資料，預計到2030年端側AI設備出貨量將達到19億台。隨著端側AI日益普及，預期相關集成電路市場將擴大。這為我們的存儲及計算芯片(CPU+NPU)創造了增量空間。

端側AI拓寬了AI的應用範圍，將傳統設備轉變為具備自主決策能力的智能終端，並進一步推動消費電子、工業應用、汽車及人形機器人等核心產業向AI領域全面發展。該等發展正推動對實時、低功耗且可靠的存儲及模擬芯片等端側AI組件的需求不斷增長，而我們的產品憑藉快速的數據訪問、高效的處理能力、精準的信號管理以及準確的感知能力等對於端側AI性能至關重要且直接對應我們的低功耗存儲及高效計算產品組合而契合這些需求。

端側AI落地需要芯片具備高性能存儲、低功耗、高可靠性三大核心能力，而我們的產品路線圖及現有產品組合與其需求相契合。我們的先進DRAM及Flash產品預計陸

業 務

續推向市場，瞄準AI高帶寬需求的3D DRAM產品正在大力投入，為端側AI存儲提供了自主可控的解決方案。

我們結合自身在CPU及神經網絡加速方面的優勢，形成了整合CPU及NPU的獨特NPU技術，實現最佳效能。我們的NPU廣泛應用於安防、門鈴等端側AI應用場景。我們依託世界級車規級存儲芯片、自研端側算力芯片提供產品，積極響應AIoT及汽車電子等廣泛應用領域的需求。

我們的計算芯片兼具高性能及低功耗特性，符合安防設備及可穿戴設備等AIoT設備的嚴苛要求。隨著AIoT的發展，智能化、電池供電及無線互聯已成為核心要求。設備的小型化趨勢及電池容量對芯片功耗提出極為嚴苛的要求。兼具對聲音、視覺、交互及環境感知等元素的分析、探測及決策功能的AI設備，亦要求芯片在一定功耗水平的情況下提供最大算力。依託我們專有的NPU架構，我們的芯片能在優化功耗的同時仍可提供充足的算力用於AI計算，加強了我們於端側AI設備設計方面的競爭力。

在機器人應用方面，根據弗若斯特沙利文的資料，自2025年至2030年，全球機器人市場預計將以複合年增長率10.5%的速度擴張。中國「十四五」機器人規劃明確2025年製造業機器人密度翻倍。AI大模型的具身化推動機器人從「工具」向「智能體」進化，為行業提供持續增長空間。我們的芯片已廣泛應用於掃地機器人、工業機器人、服務機器人、快遞機器人等領域。隨著機器人行業朝向更高智能化及場景化應用演進，我們處於有利位置，可在新時代搶佔市場份額並佔據戰略制高點，擴大了市場對我們的電機控制／電源模擬芯片及低功耗存儲芯片的需求。

3D DRAM

隨著AI的快速發展及算力設備持續升級，AI應用得到擴展。隨著計算負荷增大及數據依賴提升，市場對高容量及高帶寬、可高效支持該等應用的存儲芯片的需求激增。3D DRAM為滿足上述要求的產品。這為我們規劃中的3D DRAM產品創造了規模可觀的潛在市場。

3D DRAM通過利用先進的三維集成及垂直互聯技術實現了更高的存儲容量、帶寬和能效。該等芯片可以很好地滿足AI服務器、數據中心、端側計算設備對高帶寬、大容量、低延遲內存的需求。3D DRAM的應用場景預計將從服務器向汽車電子及AIoT等領域全面滲透，市場規模有望迎來爆發性增長。我們主要的目標是實現汽車域控制器及端側加速器的設計導入。

為緊跟新興市場趨勢，我們著手開發3D DRAM。我們的3D DRAM產品滿足了AI應用在容量、帶寬及功耗等方面的存儲要求，為本集團創造全新的產品增長機遇。

業 務

NAND Flash

汽車智能化功能越來越普及正推動車規級NAND Flash需求強勁增長。根據弗若斯特沙利文的資料，L2+及以上自動駕駛車型實時處理激光雷達、多攝像頭等傳感器產生的海量數據，單車日均數據量超1TB，對存儲芯片的讀寫速度、耐久性和在各種溫度下的穩定性提出嚴苛要求。該等需求契合我們的車規級NAND產品路線圖。

根據弗若斯特沙利文的資料，在車規儀表中，要完成對高解析度圖形及車輛狀態數據的存儲，須實現快速啟動及可靠存儲，而我們的eMMC/UFS及串行／並行NAND可滿足該需求。

工業領域亦助力NAND Flash增長。工業自動化場景中，PLC控制器、機械臂等設備需在-40°C至85°C溫度環境下連續運行，數據寫入頻次高達日均100GB，該等功能要求存儲芯片具備pSLC模式下20,000-30,000次擦寫壽命和強抗電磁干擾能力，而我們支持pSLC模式的NAND產品組合專為達到該規格而設計。

端側計算領域，工業物聯網傳感器節點、電表等終端對輕量化存儲需求旺盛，需兼顧低功耗和抗振動性能。另外，製造商越來越多地從中國大陸供應商採購。因此，有關供應商的市場份額不斷增加，有助於我們低功耗串行NAND產品的滲透。

我們已打造產品組合以解決該等市場需求。在2D NAND領域，我們已構建起串行NAND與並行NAND產品線，且採用了適配工業及汽車應用的成熟工藝節點，同時高帶寬8IO串行NAND Flash的開發工作正在推進中。在3D NAND領域，eMMC、UFS的產品方案滿足汽車座艙與自動駕駛場景的需求。依託靈活的供應鏈體系，我們正開發3D NAND產品，以實現對長生命週期需求的穩定支持，致力成為汽車電子與工業存儲芯片核心提供商。

我們的競爭優勢

「存儲+計算+模擬」芯片提供商

我們是「存儲+計算+模擬」芯片提供商。利用行業趨勢及專有技術，我們提供針對AI工作負載優化的存儲芯片、具備芯片加速及推理功能的計算芯片及實現智能感知及電源管理的模擬芯片。我們的產品廣泛應用於汽車電子、工業醫療、AIoT及安防。我們既有的市場地位帶來先發優勢並增強客戶信任，從而支持更快的設計導入、更深入的合作及持續的市場份額增長。

我們經營模式為無晶圓廠模式，據此，我們聚焦芯片的研發與設計，同時與領先晶圓廠及封測代工公司展開合作，以確保業務可擴展性。通過內生增長與戰略收購，我們成為一家擁有全面產品組合的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，我們在全球範圍的關鍵市場佔據領先地位，持續賦能汽車電子、端側計算等科技前沿領域的發展與創新。

業 務

多項自主研發的核心技術

我們的市場地位，源於我們對行業需求的深刻洞察及對自主創新的不懈堅持。憑藉在芯片設計方面深入的專業知識，我們形成了強大的自主研發能力及自研技術組合。這令我們可交付全產業鏈中從架構、IP、芯片設計、參考設計及軟件到批量生產支持的全面產品。我們在低功耗設計、高性能存儲器、計算以及汽車照明驅動等關鍵技術領域取得了顯著進步，並已形成了可在多應用場景應用的多功能技術平台。

存儲。我們專注於能滿足汽車電子及工業醫療場景的嚴苛要求的高性能高可靠性產品。我們應用於DRAM設備的片上檢錯糾錯技術可以識別兩位錯誤、糾正一位錯誤，完全符合ISO 26262功能安全標準。相比主流的外部架構，我們的設計具備低成本、易部署、高集成的優勢。在NOR Flash方面，我們採用特色工藝打造的NOR Flash，具備高帶寬、低功耗等優勢。其中，128Mb NOR Flash在讀寫與擦除速度上優於行業主流產品，並採用高可靠內置檢錯糾錯機制，數據保存能力遠超行業標準。

計算。作為中國大陸少數具備自主CPU設計能力的芯片設計公司，我們自主研發的嵌入式CPU採用了創新的微體系結構，在主頻、功耗和面積性能方面均達到業界領先水平。隨著RISC-V CPU架構成為事實上的行業標準，我們基於此架構開發一系列CPU內核。該等CPU內核應用於我們的各條計算芯片產品線。

此外，我們亦開發其他核心計算技術。我們的視頻處理技術支持大多數主流視頻格式，且旨在實現性能、面積及功耗方面的高效益。通過結合我們在CPU及神經網絡加速方面的優勢，我們已構建獨特的神經網絡處理單元，實現最優效益。我們的神經網絡處理單元實現計算效率與靈活性之間的平衡，相同功耗下性能更佳，能效方面實現了先進的行業水平。我們的圖像信號處理技術支持2D/3D降噪、寬動態、自動抗頻閃及噪聲建模等前沿功能。我們亦在圖像信號處理方面取得了突破，利用AI實現自適應降噪、寬動態範圍及細節重建及增強，進一步提高了畫質。

模擬。我們提供模擬芯片組合，配備汽車照明及燈效控制技術。我們自主研發的燈效矩陣驅動整合了優化算法、去鬼影功能，實現了無頻閃、低噪聲、無鬼影、低功耗。該等技術為新興市場的高品質的燈效提供支持。我們始終秉持技術創新與品質至上的理念，不斷優化產品性能，拓展應用領域，以滿足多場景中對照明產品日益增長的需求。

業 務

於往績記錄期間，我們將收入的15.1%投入研發，足證我們對創新及研發堅定不移的承諾。截至2026年3月31日，我們亦配備一支由822名工程師組成的研發團隊，聚焦核心技術與產品的持續研發迭代。截至同日，我們持有專利812項，為我們可持續增長奠定基石。

通過核心技術要素整合的產品組合

我們提供涵蓋存儲、計算和模擬芯片的廣泛產品組合，其中融合了我們自主研發的核心技術。我們的產品旨在滿足特定需求，並廣泛應用於汽車電子、工業醫療、AIoT及安防等各種高增長領域。

為滿足該等市場的具體要求，我們的芯片設計旨在實現高性能、低功耗、高可靠性及長產品壽命。具體而言，我們提供的車規級和工業級芯片在可靠性、一致性和環境兼容性方面比消費電子產品具有更高的標準。

我們將核心技術直接整合至三大產品線：

存儲芯片。

我們運用在DRAM、SRAM、NOR Flash及NAND Flash領域的專業技術，透過先進的存儲單元與電路架構、低功耗外圍電路設計以及穩健的可靠性工程，將該等技術融入產品設計之中。我們整合檢錯糾錯、磨損及數據保持管理和製程偏差容忍技術，確保在汽車、工業與醫療環境中實現數據完整性及持久性，同時協同優化控制器及接口，達成確定性延遲及高帶寬的雙重目標。

計算芯片。

我們將自主研發的CPU內核(XBurst/MIPS及Victory/RISC-V)嵌入系統，作為控制調度的中樞骨幹，並與自研的NPU緊密耦合，實現設備終端低延遲、低功耗的AI推理。這兩項技術構成了我們用於智能視覺及端側應用的計算芯片的核心。我們的視頻及圖像處理技術，如VPU/ISP模組，透過加速視頻與影像處理流程，並藉由工具鏈實現快速模型部署，進一步完善此基礎架構。

模擬芯片。

我們將模擬技術－精密模擬設計、電源管理、LED驅動器架構、照明控制算法以及穩健的LIN/CAN接口－整合至汽車、工業及家電產品中。透過整合低噪音、高精度的混合信號模組，結合高效能功率級與符合安全標準的通訊技術，我們提供可靠且高度整合的模擬芯片，專為滿足系統層級需求而量身打造。

隨著AIoT市場不斷擴張，設備正向著智能化、無線互聯、電池供電式運行的需求方向發展。AI眼鏡、電池供電式門鈴及攝像頭等產品的小型化對功耗及物理尺寸提出嚴格要求。同時，該等設備必須能支持先進AI功能，例如聲音、視覺、交互及環境感知方面的分析、探測及決策，這些功能要求在有限的功耗分配內實現高算力。

業 務

憑藉我們的自研NPU架構，我們交付的芯片可在計算性能與能效之間取得平衡，令我們的客戶得以開發智能化、電池續航久、工作壽命長、AI功能強大的設備，在不斷變化的智能設備格局中為我們創造了獨特的競爭優勢。

我們與頭部客戶的長期合作關係證明了我們產品的性能和質量，以及我們解決不同行業痛點和需求的能力。我們的芯片廣泛應用於各領域全球知名Tier 1廠商的產品中。

強大的供應鏈和質量管理體系

我們與供應鏈合作夥伴的互惠互利關係，鞏固了我們滿足市場對高規格芯片需求的能力。截至2026年3月31日，我們與18家優質晶圓廠合作夥伴在芯片製造方面緊密合作，並與28家封測代工合作夥伴在芯片封裝和測試方面緊密合作。此外，我們已戰略性地開發國內和海外供應鏈體系，以滿足全球客戶的需求，確保供應鏈的韌性。

我們建立了完善的質量管理制度，獲得ISO 9001認證，並符合ISO 14001環境標準，對建立下游客戶的信任至關重要。對於汽車電子，我們已根據IATF 16949要求制定供應鏈管理制度。我們設有專門的實驗室和流程，確保所有車規級芯片均能夠通過AEC-Q100認證測試，客戶可獲得相應報告。我們的質量管理制度規範內部營運，並為晶圓廠及外包合作夥伴制定明確基準，保障始終如一的產品質量，滿足各行業的技術要求。

兼具屬地化服務的國際銷售網絡

我們的銷售網絡覆蓋諸多國家及地區，包括中國、北美、南美、歐洲、韓國、日本及東南亞。我們與重要領域領先經銷商與客戶保持了長期戰略合作夥伴關係。我們的經銷合作夥伴「主要」為知名電子元器件經銷商。

我們的銷售團隊由上百名具有豐富行業經驗的屬地銷售人員組成，在他們的幫助下，我們的產品銷往約50個國家及地區的下游客戶，全面覆蓋亞洲、美洲、歐洲等世界主要國家及地區，擁有廣泛的客戶群和屬地化服務能力。

通過銷售網絡及屬地化服務，我們可優化資源分配，進行業務佈局與市場規劃。我們的銷售網絡通過區域內員工、授權經銷商及銷售代表，以及出行支持團隊的組合，提供屬地化服務。這使我們能夠把握行業發展和變革的機會，不斷挖掘新的機遇，持續擴展客戶群。

業 務

跨文化協同的國際化人才團隊

核心人才團隊構成我們企業發展堅實的基礎。我們的創始人、董事長及總經理劉強博士兼具清華大學與中科院的深厚技術根基，是中國嵌入式CPU領域的先行者之一；同時其以前沿的戰略眼光，通過收購ISSI等工作，引領我們從本土設計商躍升為汽車電子關鍵供應商，產品亦拓展至存儲、計算及模擬全譜系。劉博士入選科技北京百名領軍人才，以「技術+併購」雙輪驅動模式，助力我們持續發展。

我們擁有一支國際化的芯片設計團隊，成員分佈在中國、美國、以色列、韓國、日本等國家，涵蓋存儲芯片設計、計算芯片設計、模擬芯片設計等多個領域。我們通過多年的技術積累和人才培養，形成了合理的人才梯隊，並通過股權激勵等不斷加強團隊凝聚力。此外，我們每年均選派骨幹進行跨境交流，在各條線產品的研發過程中均存在境內外團隊協作開發，跨文化管理機制持續激發我們的創新活力。

我們的發展戰略

強化技術與產品佈局

我們旨在強化存儲、計算及模擬產品線的技術與產品規劃，確保我們的技術創新、產品開發及市場擴張相互促進，相輔相成。

- **技術開發。**我們致力於構建以存儲和計算為核心，自主穩健的技術體系。具體而言，我們計劃(i)採用多核異構計算架構，通過「專用核心+協同調度」的方式，在緊湊的物理空間內實現高算力和低功耗；(ii)為嵌入式CPU採用RISC-V架構以充分利用其生態系統；(iii)結合AI算法的發展動態優化NPU架構，根據不同場景定制NPU計算單元，在算力和功效之間取得平衡；(iv)優化AI-ISP技術，提升複雜場景下的成像效果；及(v)專注3D DRAM的研發，以提高容量、帶寬和降低功耗。
- **產品組合。**我們旨在優化所有產品線的AI應用產品組合。具體而言，我們計劃(i)為自動駕駛、智能座艙及AIoT應用場景推出高容量、高帶寬存儲芯片，使其每秒能傳輸與儲存更多數據，相較於現有存儲產品，可實現更流暢的感知與決策能力；(ii)透過提升芯片內運算並優化功耗，升級與迭代適用於AIoT及安防的計算芯片，使設備相較現有產品能在本地運行更複雜的模型，具備更快的響應速度、更長久的續航；(iii)推出適用於汽車環境的eMMC及UFS產品，提供更快的應用程序載入與數據存取速度，並具備更優異的可靠性，相較於當今通用型存儲產品，能全面滿足自動駕駛及座艙應用需求；(iv)推動新型存儲芯片（如3D DRAM）的發展，該技術透過堆

業 務

疊存儲體層，在相同面積下實現更高帶寬及密度，相較於現行2D設計，能支持端側更龐大的AI工作負載；及(v)專注於車規級LED驅動器和Combo芯片，此類產品具備更高整合度、更寬廣的溫度容差及更嚴格的安全合規性，相較於現有消費級元件，更易於應用於汽車電子、工業及家電領域。

- **市場認可度。**我們計劃充分利用與汽車OEM、Tier 1供應商和AIoT設備製造商已建立的合作夥伴關係，積極推廣新產品。我們還計劃加強與行業龍頭企業的合作，並加強技術支持，以推動AI眼鏡、機器人、自動駕駛和攝像頭等AI賦能設備的應用。

深化車規芯片產品升級與矩陣拓展

我們旨在升級車規級存儲芯片，在新興產品採用先進DRAM工藝技術。我們計劃拓展產品矩陣，從DDR3／DDR4／LPDDR4到LPDDR5。同時，我們計劃投入開發3D DRAM技術，通過混合鍵合提升帶寬和能效。

依託車規級DRAM、SRAM和NOR Flash的領先優勢，我們計劃積極拓展ADAS、智能座艙等新場景。針對汽車電動化、智能化及網聯化加速發展的趨勢，我們計劃推出2D NAND與3D NAND產品系列，模擬芯片持續推出高精度LED驅動芯片，持續穩固我們作為新興汽車綜合半導體產品供應商的市場地位。

強化銷售網絡

面對半導體行業週期波動與AI技術帶來的新機遇，我們計劃進一步強化銷售網絡。我們的銷售網絡通過區域內員工、授權經銷商及銷售代表，以及出行支持團隊的組合，提供屬地化服務。我們針對不同地區市場特性制定差異化策略，在汽車產業集中區域強化車規級存儲與模擬芯片的場景化推廣，而在端側計算興起的市場重點佈局端側AI芯片方案。同時，我們還加強技術服務團隊建設，為重點客戶提供定制化技術支持與快速問題響應。

通過實施此戰略，我們將更精準捕捉半導體市場需求，助力AI技術與車規、工業等核心業務的深度融合，為我們未來發展奠定堅實基礎。

沿產業鏈尋求側重性投資併購

作為內生增長的補充，我們密切關注市場趨勢，識別具備技術互補性、市場協同性、資源匹配性的併購標的，統籌橫向技術整合與縱向產業延伸，通過投資與併購獲取關鍵技術與資源，構建更具競爭力的技術及產品生態系統。

實施層面上，我們將注重通過技術互補及資源整合填補技術空白，縮短研發週期，同時保障供應鏈韌性。我們會優先選擇與現有核心業務協同效應顯著的標的。我

業 務

們通過併購快速獲取專利、人才與市場渠道，逐步構建從芯片設計到場景應用的完整生態，為車規、工業等核心市場提供更具競爭力的產品，支撐長期增長。

加強人才資源配置

人才資源是支撐我們未來持續發展的核心保障。我們聚焦存儲、車規、端側AI等核心賽道，將人才戰略與技術研發、市場拓展深度綁定，通過構建跨地域、多層次的人才網絡，為前沿技術攻堅和產品升級提供智力支撐。

我們一方面計劃擴大人才版圖，重點吸納存儲架構設計、AI算法優化、車規級芯片設計等領域的國際頂尖專家，強化與科研機構的合作，搭建技術交流平台；另一方面深化內部人才培育，通過核心技術項目歷練、股權激勵計劃等方式，穩定核心研發團隊並激發創新活力。採用「引才+本土育才」的模式，保障我們技術路線的前瞻性，夯實可持續發展的人才根基，為我們在芯片設計與研發領域的持續突破與市場競爭力提升提供堅實支撐。

我們的發展歷程

我們從2005年開始涉足CPU設計，持續積累計算芯片技術的深厚專業知識。2020年，我們收購ISSI，擴展產品組合，增添存儲和模擬芯片產品線。如今，我們已成為領先的芯片供應商，擁有覆蓋存儲、計算和模擬芯片的綜合能力，服務多元化的市場與應用。

我們的存儲芯片產品線以ISSI為品牌，包括DRAM、SRAM及Flash產品，專為汽車電子及工業醫療場景定制。

我們的計算芯片產品線以Ingenic為品牌，包括智能視覺SoC、嵌入式MPU及AI-MCU，廣泛應用於AIoT及安防場景的設備。

我們的模擬芯片產品線以Lumissil為品牌，涵蓋LED驅動器及其他面向汽車電子、工業及家電的Combo芯片。

我們自成立以來一直採用無晶圓廠業務模式經營，使我們能夠專注於芯片設計和創新，同時與優質晶圓廠和封測代工合作夥伴合作，確保業務可擴展性及高品質產品。

我們的產品

我們的產品組合涵蓋三大產品線：存儲芯片、計算芯片及模擬芯片。經過多年的積累與創新，我們已開發出主要應用於汽車電子及工業醫療的存儲芯片（包括DRAM、SRAM、NOR Flash及NAND Flash），應用於AIoT及家庭安防的計算芯片，應用於汽車電子、工業及家電的模擬芯片（包括LED驅動芯片及Combo芯片）。我們的產品符合車規級及工業級標準，具備高品質、高可靠性、低能耗及產品壽命長的特點。

業 務

存儲芯片

我們的存儲芯片產品線包括DRAM、SRAM、NOR Flash及NAND Flash，旨在滿足汽車電子及工業醫療領域的嚴苛要求。對於汽車領域，該等要求包括在車規級生產、篩選及變更控制流程的基礎上實現寬溫及寬濕等級、經驗證的可靠性、長期供應及生命週期支持、更強的數據保持能力及耐久性、較低的可接受缺陷率。該系列產品專為在嚴苛工作環境下實現高性能、高可靠性及高能效而設計。我們的存儲芯片產品通常有自量產之日起計五至20年的產品生命週期。在此期間，我們升級及迭代相關工藝節點同時保持引腳對引腳兼容性，以確保對客戶的長期供應。

計算芯片

我們的計算芯片產品線包括一系列基於我們自研核心計算技術的高性能低功耗SoC，例如CPU、VPU、NPU、ISP及AI-ISP。該等產品涵蓋三個子產品線：智能視覺SoC、嵌入式MPU及AI-MCU。該等產品旨在實現高性能及低功耗，滿足各種設備不斷變化的需求，主要包括安防攝像頭、門鈴、AR眼鏡、掃地機器人、二維碼／條形碼識別及人臉和指紋識別。我們亦正在採用RISC-V作為我們計算芯片的主要架構，充分利用其開放性及靈活性，以進一步加強我們的技術競爭力。我們的計算芯片產品通常有五至15年的產品生命週期。

模擬芯片

我們為汽車電子、工業及家電設計模擬芯片，應用於照明、觸控、音頻、電源與控制應用領域。我們亦提供多功能Combo芯片，將MCU、LED驅動器、電源管理及通信接口（如CAN或LIN）集成到單一芯片。我們的模擬芯片產品通常有五至20年的產品生命週期。

下表列示我們於所示年度／期間按產品線劃分的收入。

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	(人民幣千元，百分比除外)						(未經審計)			
存儲芯片										
DRAM	1,590,161	35.1%	1,328,242	31.5%	1,414,456	29.8%	338,247	31.9%	522,348	33.5%
Flash	868,836	19.2%	883,461	21.0%	1,095,127	23.1%	231,991	21.9%	372,613	23.9%
SRAM	452,561	10.0%	377,789	9.0%	401,671	8.5%	92,317	8.7%	122,909	7.9%
小計	2,911,558	64.3%	2,589,492	61.5%	2,911,254	61.4%	662,555	62.5%	1,017,870	65.3%
計算芯片										
智能視覺SoC	945,450	20.9%	906,385	21.5%	997,410	21.1%	216,836	20.5%	308,200	19.7%
嵌入式MPU	162,921	3.6%	183,719	4.4%	296,001	6.2%	53,270	5.0%	94,507	6.1%
小計	1,108,371	24.5%	1,090,104	25.9%	1,293,411	27.3%	270,106	25.5%	402,707	25.8%

業 務

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
					(人民幣千元，百分比除外)					
							(未經審計)			
模擬芯片										
LED驅動芯片	393,214	8.7%	450,874	10.7%	484,889	10.3%	113,268	10.6%	128,214	8.2%
Combo芯片	15,704	0.3%	20,648	0.5%	20,750	0.4%	6,001	0.6%	4,200	0.3%
小計	408,918	9.0%	471,522	11.2%	505,639	10.7%	119,269	11.2%	132,414	8.5%
其他 ⁽¹⁾	102,079	2.3%	61,508	1.5%	30,704	0.6%	8,302	0.8%	6,776	0.4%
總計	4,530,926	100.0%	4,212,626	100.0%	4,741,008	100.0%	1,060,232	100.0%	1,559,767	100.0%

附註：

(1) 主要包括銷售其他商品（包括開發板）、提供技術服務及租賃收入。

下表列示我們於所示年度／期間的芯片銷量及平均售價。

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	銷量	平均售價 ⁽¹⁾	銷量	平均售價 ⁽¹⁾	銷量	平均售價 ⁽¹⁾	銷量	平均售價 ⁽¹⁾	銷量	平均售價 ⁽¹⁾
	(千顆)	(人民幣元)	(千顆)	(人民幣元)	(千顆)	(人民幣元)	(千顆)	(人民幣元)	(千顆)	(人民幣元)
							(未經審計)			
存儲芯片	415,932	7.0	479,042	5.4	602,424	4.8	137,678	4.8	191,036	5.3
計算芯片	75,503	14.7	93,526	11.7	120,868	10.7	23,739	11.4	26,632	15.1
模擬芯片	179,356	2.3	217,335	2.2	250,252	2.0	56,748	2.1	64,340	2.1

附註：

(1) 平均售價按收入除以同年／期的相關銷量（即我們向客戶銷售產品的平均價格）計算。

存儲芯片

DRAM

動態隨機存取存儲器(DRAM)是一種廣泛使用的易失性存儲器，以高密度存儲與成本效益為特點。我們專注於專為對性能、可靠性或工作環境有特定要求的應用領域而設計的利基型DRAM，而不是大規模生產的標準型DRAM。我們提供全面的DRAM產品組合，包括SDR、LPSDR、DDR、DDR2、LPDDR2、DDR3、DDR4及LPDDR4，旨在支持要求高速數據處理、高能效和可靠性能的各種應用。

DDR存儲器每個時鐘週期傳輸兩次數據，速率、能效和存儲密度更高。DDR4為該技術的第四代產品，性能較前幾代顯著提升。LPDDR專為移動設備和功耗敏感型應用設計，其工作電壓低於標準DRAM，非常適合任何注重能效的應用領域。

業 務

根據弗若斯特沙利文的資料，以2025年收入計，我們是總部位於中國大陸的第二大利基型DRAM供應商及全球第七大利基型DRAM供應商。

規格

下表列示我們的主要DRAM產品。

產品系列	容量	速率	工作 溫度範圍	主要 應用領域
SDR	16Mb-512Mb	143Mhz-200Mhz	-40°C-115°C	工業醫療和 汽車電子
LPDDR	32Mb~512Mb	133Mhz~166Mhz	-40°C-105°C	工業醫療和 汽車電子
DDR	256Mb-512Mb	166Mhz-200Mhz	-40°C-105°C	工業醫療和 汽車電子
DDR2	256Mb-2Gb	667Mbps- 800Mbps	-40°C-115°C	工業醫療和 汽車電子
DDR3	1Gb-16Gb	1600Mbps- 2133Mbps	-40°C-125°C	工業醫療和汽車 電子
DDR4	4Gb-16Gb	2400Mbps- 3200Mbps	-40°C-125°C	工業醫療和 汽車電子
移動DRAM				
LPDDR	32Mb-2Gb	166Mhz-200Mhz	-40°C-115°C	工業醫療和 汽車電子
LPDDR2	256Mb-8Gb	400Mhz-533Mhz	-40°C-115°C	工業醫療和 汽車電子
LPDDR4	2Gb-32Gb	3200Mbps- 4266Mbps	-40°C-125°C	工業醫療和 汽車電子

應用場景

我們的DRAM產品對性能密集型應用至關重要。在汽車電子領域，其應用於：

- **座艙**：支持高分辨率數字儀表、AR導航及個性化座艙體驗。
- **自動駕駛系統**：促進實時數據處理，支持物體檢測、路徑規劃、決策的AI模型運行。
- **電池管理**：通過高速可靠存儲芯片保障電動汽車高效能源管理。

我們的DRAM亦對AI設備與物聯網系統發揮關鍵作用，為數據密集型運算提供所需帶寬及容量，同時保持低功耗。

業 務

SRAM

靜態隨機存取存儲器(SRAM)是一種無需定期刷新的易失性存儲器，在部分應用中相比DRAM速度更快、可靠性更佳。我們的SRAM產品組合涵蓋同步SRAM、異步SRAM以及高性能QDR SRAM。PSRAM兼具SRAM的簡單性和DRAM的高密度優勢，為要求大容量內存及低功耗的應用領域提供經濟高效的低功耗解決方案，特別適用於注重能源效率和緊湊設計的移動設備、物聯網應用和可穿戴電子設備。

我們的SRAM產品支持高速低時延、寬溫域環境、長生命週期運行，確保在汽車和工業應用等嚴苛環境中的可靠性。根據弗若斯特沙利文的資料，以2025年收入計，我們是全球第二大SRAM供應商，及以2025年收入計，我們在總部位於中國大陸的公司中排名第一。

規格

下表列示我們的主要SRAM產品。

產品	容量	速率	工作溫度範圍	主要應用領域
同步SRAM	2Mb-72Mb	133Mhz-250Mhz	-40°C-125°C	通信、汽車、工業
高速異步SRAM . .	64Kb-4Mb	10-12ns	-40°C-85°C	工業醫療和汽車
低功耗異步SRAM	256Kb-8Mb	45-55ns	-40°C-125°C	工業醫療和汽車
高速低功耗異步SRAM	256Kb-32Mb	8-12ns	-40°C-125°C	工業醫療和汽車
PowerSaver™ 低功耗異步SRAM	256Kb-16Mb	35-55ns	-40°C-125°C	工業醫療和汽車
偽SRAM	8Mb-64Mb	70ns	-40°C-105°C	工業醫療和汽車
串行SRAM及串行RAM	512Kb-128Mb	104Mhz-133Mhz	-40°C-105°C	工業醫療
HyperRAM/OctalRAM.	32Mb-1Gb	133Mhz-250Mhz	-40°C-105°C	工業醫療和汽車
QDR SRAM.	18Mb-72Mb	250-550Mhz	-40°C-85°C	通信

應用場景

我們的SRAM產品尤為適合注重可靠性、性能和環境適應性的汽車電子。該系列芯片廣泛應用於：

- **高級輔助駕駛系統：**支持碰撞避免、車道保持輔助等汽車安全功能的實時數據處理。
- **信息娛樂系統：**為影音播放、導航及通信系統提供高速可靠的數據存儲。

業 務

- **動力總成控制系統**：通過高速、低時延存儲器支持發動機和變速箱系統，實現實時監測調控。
- **工業醫療**：為注重實時數據處理和可靠性的可編程邏輯控制器、電機控制系統和工廠自動化提供強大且高效的存儲芯片。
- **通信**：通過提供高速、低時延存儲器來增強基站、路由器和交換機的性能，實現數據緩衝、信號處理和協議管理。

此外，SRAM支持寬溫域環境運行與環境應力耐受性，使其成為汽車系統在極端環境下運行的關鍵組件。

Flash

Flash存儲器是一種非易失性存儲器，即斷電亦能保留數據。我們的Flash存儲芯片產品線包括NOR Flash及NAND Flash。NOR Flash經過優化以適用於快速、可靠的代碼執行，而NAND Flash專為數據存儲而設計。我們的Flash存儲器針對嵌入式系統、汽車電子和工業應用而設計。

NOR Flash

NOR Flash允許隨機訪問數據，支持直接從存儲器快速可靠運行代碼，因此廣泛應用於需頻繁快速讀取可運行代碼的嵌入式系統。相較並行NOR Flash，主流SPI NOR Flash因其成本相對較低、尺寸緊湊、更易集成於空間和功耗敏感型應用，以及在嵌入式系統和微型可穿戴設備等應用中日漸普及等優勢，成為我們的專注領域。根據弗若斯特沙利文的資料，以2025年收入計，我們是全球第七大NOR Flash供應商，及以2025年收入計，我們在總部位於中國大陸的公司中排名第三。

規格

下表列示我們NOR Flash產品的主要規格。

產品	密度	電壓	速率	溫度
串行NOR Flash . . .	1Mb-2Gb	2.5V/3V	104、133、 166MHz	-40°C-125°C
帶ECC校驗串行 NOR Flash	128Mb-2Gb	1.65V-2.0V 2.3V-3.6V	50、133 80、166MHz	-40°C-125°C
並行NOR Flash . . .	32Mb-256Mb	2.7V-3.6V	70ns	-40°C-125°C
安全加密NOR Flash (RPMC)	32Mb-256Mb	1.65V-2.0V 2.3V-3.6V	66、133 80、166MHz	-40°C-105°C
八通道NOR Flash (xSPI).	32Mb-2Gb	1.70V-2.0V 2.7V-3.6V	133、 200MHz	-40°C-125°C

NAND Flash

NAND Flash具有大存儲容量、快速擦寫速度以及長使用壽命，使其適用於各種大容量存儲應用。我們專注於SLC 2D NAND Flash，相較MLC及TLC 2D NAND Flash，容量較小，但可靠性和耐用性更高。我們的NAND Flash適用於需要高可靠性的性能導向型應用。

業 務

我們的產品組合包括SPI NAND Flash、車規級SPI NAND Flash、並行NAND Flash和車規級並行NAND Flash。我們的車規級NAND Flash產品搭配我們的車規級NOR Flash，已廣泛應用於電動汽車的智能座艙、自動駕駛系統、智能通信和動力總成系統。

我們亦提供管理型NAND。管理型NAND將NAND Flash與複雜的控制器和固件集成於單個封裝，使存儲器能夠實現自我管理，在內部處理磨損均衡、壞塊管理和糾錯等任務，從而免除主機系統的這些任務負擔。我們的產品包括eMMC及UFS，採用緊湊設計、性能可靠，廣泛應用於移動、汽車和工業市場。

規格

下表列示我們2D NAND Flash和3D（管理型）NAND Flash產品的主要規格。

產品	密度	電壓	速率	溫度
2D NAND Flash				
SPI NAND Flash . .	1Gb-4Gb	1.8V/3.3V	104MHz	-40°C-105°C
並行NAND Flash . .	1Gb-8Gb	1.8V/3.3V	25ns	-40°C-105°C
3D（管理型）NAND Flash				
eMMC	4Gb-128Gb	VCCQ = 1.8 V/3.3 V VCC = 3.3 V	200MHz	-40°C-105°C
UFS	64Gb-256Gb	VCCQ = 1.2V VCC = 2.5/3.3 V	/	-40°C-105°C

應用場景

NOR Flash廣泛應用於汽車電子的以下領域：

- **啟動操作與固件存儲：**確保信息娛樂系統、ADAS等各種汽車系統的可靠代碼運行。
- **動力總成系統：**支持溫度敏感環境下的實時操作。

NAND Flash非常適合需要大容量存儲的應用，例如：

- **高級輔助駕駛系統：**存儲實時計算所需的大型數據集和AI模型參數。
- **數據記錄器：**記錄、分析車輛性能數據，用於診斷優化。

除汽車應用外，NOR Flash存儲器亦廣泛應用於注重惡劣環境下的可靠性和耐用性的工業設備和物聯網系統。

業 務

計算芯片

智能視覺SoC

智能視覺SoC為半導體產品，專為視頻及圖像獲取、處理、分析及儲存而設計。我們的智能視覺SoC產品線主要包括IP-Cam SoC、ISP及NVR（網絡視頻錄像機）SoC，組成適用於各種應用的綜合視覺處理產品。

- **IP-Cam SoC**：集成ISP、視頻編碼等關鍵功能，以為網絡攝像機提供一體化算力。
- **ISP**：專業優化原始圖像信號及提升整體畫質。
- **NVR SoC**：負責儲存及管理網絡視頻流。

該等產品相輔相成，共同滿足多種場景中的多樣化視覺處理需求。我們的智能視覺SoC結合先進視頻圖像處理能力與AI賦能功能，實現高品質視覺性能及低功耗。其廣泛應用於可穿戴相機、AI眼鏡、運動相機、醫療和專用設備、門鈴、安防攝像頭及網絡視頻錄像機等應用。

根據弗若斯特沙利文的資料，以2025年收入計，我們是全球第二大智能視覺SoC供應商及以2025年收入計，我們是全球第二大IP-Cam SoC供應商。

下表列示我們的主要智能視覺SoC產品。

產品	主流 ⁽¹⁾	入門級 ⁽²⁾	低功耗 ⁽³⁾
T23		√	√
T31		√	√
T32	√		√
T33		√	√
T41	√		√
T40	√		√
C100		√	√
A1	√		

附註：

(1) 指AI計算性能為超過0.5不超過2 TOPS (INT8)的智能視覺SoC。

(2) 指算力最高為0.5 Top的產品。

(3) 指運行功耗低於400mW的智能視覺SoC。

主要特點

我們的智能視覺SoC具備自研CPU、VPU、ISP及NPU，實現高性能、高集成度及低功耗，以滿足對先進視頻處理及AI驅動成像應用不斷增長的需求。

業 務

先進的成像和視頻處理。我們的自研ISP支持多級降噪(2DNR/3DNR)、動態範圍調整和圖像銳化等功能，即使在苛刻的光照條件下亦能確保清晰細膩的視覺效果。自研VPU支持最高4K (2160p)分辨率、實時錄製速率最高30fps的H.264及H.265視頻編碼。AI賦能ISP通過自適應降噪、寬動態範圍、細節重建及情景優化進一步提高了視頻質量，非常適合安防攝像頭及機器視覺等應用。

對AI的有力支持。我們的智能視覺SoC配備自研NPU，支持實時物體檢測、人臉識別和智能視頻分析等先進AI應用。這些功能對家庭安防、自動駕駛及工業安防至關重要。為加速AI應用開發，我們的平台為開發者提供高效實施及應用定制AI解決方案的工具與資源。

高效緊湊設計。我們的SoC為低功耗而設計，非常適合安防攝像頭、可穿戴相機、AI眼鏡和便攜式醫療成像系統等電池續航設備。超緊湊型C100系列的封裝尺寸僅5 mm × 6 mm，可集成於內窺鏡及AI眼鏡等空間受限設備，實現輕量便攜的設計。

全接口系統集成。我們的智能視覺SoC支持廣泛的I/O接口，實現與外設無縫連接，包括支持MIPI CSI影像輸入、支持即插即用音視頻設備的UVC/UAC及支持DMIC高級音頻輸入。實時時鐘、集成音頻編解碼器和快速啟動技術等附加功能增強系統集成度及用戶體驗，賦能客戶為多元化市場打造功能強大且方便易用設備。

應用領域

我們的智能視覺SoC支持廣泛的應用場景，滿足消費和工業市場的需求：

- **可穿戴相機及AI眼鏡：**為便攜式設備（包括可穿戴相機和AI眼鏡）提供輕量化低功耗視頻錄製。
- **安防攝像頭：**通過高效視頻壓縮和AI賦能分析，為人臉識別和動態偵測等安全應用場景提供實時、高清監控。
- **運動相機：**具備防抖追蹤、目標跟隨、實時分析等先進功能的高清視頻錄製。
- **醫療和專用設備：**支持內窺鏡、工業檢測儀、手術直播設備等應用的緊湊型低功耗視頻產品。
- **門鈴：**通過AI攝像頭門鈴實時提醒有人來訪並實現雙向通話。
- **NVR：**實現安全系統的可靠視頻錄製存儲產品。

業 務

嵌入式MPU

嵌入式MPU作為新興類別，近年來逐漸嶄露頭角，其定位介於傳統MCU（側重實時控制）與應用處理器（專注於出色算力）之間。嵌入式MPU的核心優勢在於其能融合應用處理器的數據處理能力與MCU的實時控制功能，從而形成兼具出色算力與快速響應實時控制能力的跨界產品。

我們的嵌入式MPU採用緊湊型芯片設計，在單芯片集成多個CPU內核與專用引擎、存儲器、定時器及外圍電路。作為智能設備的計算和控制單元，該系列MPU專為高性能及低功耗而設計。

我們的嵌入式MPU產品廣泛應用於機器人、人臉及指紋識別設備、打印機、二維碼／條形碼識別設備、顯示與控制設備、教育電子設備及數據傳輸設備等多元化物聯網應用場景。

下表列示我們的主要嵌入式MPU產品。

產品	高性能 ⁽¹⁾	主流 ⁽²⁾	低功耗 ⁽³⁾	專用 ⁽⁴⁾
X1500			√	√
X1600		√	√	√
X2000	√		√	
X2600	√			

附註：

- (1) 指使用XBurst2 CPU用於高算力及快速處理速度的產品。
- (2) 指平衡取舍性能與成本的產品。
- (3) 指待機功耗低於2.0mW的產品。
- (4) 指為特定行業或應用領域（如條碼掃描設備）量身定制的產品。

主要特點

多核異構架構。我們的嵌入式MPU採用多核異構架構，在單芯片集成自研高性能CPU內核與VPU、ISP及顯示控制器等多個功能模塊，實現算力與能效之間的最優平衡。主CPU搭載1-3個運行頻率最高1.2GHz的內核，處理高負載任務，輔助搭載一個運行頻率300MHz的RISC-V內核，專為實時控制任務優化。該架構非常適合工業自動化、汽車電子和端側計算，該類場景對高性能與低功耗要求嚴苛。

端側計算。我們的嵌入式MPU集成自研的NPU，可實現圖像識別、語音處理、音頻分析等先進AI應用。設備端AI處理降低時延、增強安全性並提升整體效能，使該等產品非常適合家居、機器人和工業物聯網場景。

業 務

先進的成像和視頻功能。我們的嵌入式MPU支持高清圖像與視頻處理，集成ISP，支持最高1080p@60fps的視頻分辨率及最高1920 x 1080的靜態圖像。其亦支持H.264解碼器、MJPEG視頻編解碼器及音頻編解碼器，以及二維圖形和顯示處理單元，滿足工業與消費應用領域對高分辨率視頻日益增長的需求。

全面連接及接口。我們的嵌入式MPU搭載多協議輸入輸出接口，確保各種應用無縫集成。主要特點包括支持MIPI CSI及DVP圖像輸入、支持MIPI DSI及LVDS顯示輸出以及支持USB、CAN、UART及SPI通信。對於網絡連接，其支持RMII，同時通過PWM及GPIO接口加強實時控制，實現高效的外設管理。該等豐富的接口使我們的MPU適應性強，滿足現代智能系統不斷變化的需求及可靈活應用於多元化應用場景。

應用領域

我們的嵌入式MPU廣泛應用於多樣化的應用場景，為各行業賦能智能化功能：

- **機器人：**賦能掃地機器人和除草機器人等設備。
- **人臉及指紋識別設備：**賦能指紋、人臉、靜脈識別系統，應用於考勤打卡、門禁管理及關卡安檢場景。
- **打印機：**用於元件打印、外殼打印、玩具和打印農場的專用3D打印機；消費電子領域的照片打印機；適合辦公室、出版和家庭使用的激光打印機；適合辦公室、工廠和家庭使用的噴墨打印機；物流運輸及零售行業專用標籤打印機。
- **二維碼／條形碼識別設備：**支持二維碼及條形碼掃描，覆蓋零售支付、物流運輸、關卡安檢、藥品分揀及工業生產領域。
- **顯示與控制設備：**家居場景的可視對講系統、安防顯示器、家居控制面板；零售LCD電子價簽、電子相框、工業顯示屏；支持LED屏幕的數據傳輸與顯示控制的LED顯示控制。
- **教育電子設備：**賦能掃描翻譯筆、電子詞典、點讀筆等設備。
- **數據傳輸設備：**支持移動終端和音頻播放設備數據傳輸，或實現各行業應用的數據處理及安全傳輸。

AI微控制器(AI-MCU)

AI-MCU是一種基於通用MCU架構的芯片產品，通過集成用於AI計算的NPU模塊強化功能。AI-MCU通過結合實時控制邏輯與設備端AI推理，保留了傳統MCU的優勢，如精準硬件控制及超低功耗，同時通過NPU大幅提高AI算法處理能力。

業 務

我們的AI-MCU集成了RISC-V CPU、NPU及片上存儲，使設備可執行本地化智能任務。與通用MCU相比，我們的AI-MCU憑藉其兼具超低功耗與強大的AI處理能力脫穎而出。在非AI運作模式中，芯片可關閉NPU以維持極低功耗，且僅於觸發AI任務時啟動NPU，實現控制與智能的無縫集成。

我們的AI-MCU採用多核異構架構，集成RISC-V內核與用於高效設備端AI推理的微型神經處理單元。芯片搭載MIPI-DSI/CSI、以太網和USB OTG等多功能接口。憑藉超低功耗運行和多電源域控制，待機功耗可達致微安級，令我們的AI-MCU非常適合電池續航設備及持續在線的應用。

截至最後實際可行日期，我們已完成多項目晶圓（「MPW」）的工程樣品驗證測試，目前正在為AI-MCU的量產版本作設計修改。

主要特點

我們的AI-MCU採用多核異構架構，集成自研RISC-V內核與算力最高0.5 TOPS用於高效AI推理的微型神經處理單元。其支持內置4MB至32MB PSRAM，以及搭載MIPI-DSI/CSI和USB OTG等各種接口。

主要應用場景

我們的AI-MCU產品適用於廣泛的行業，具有高性能、低能耗和多功能接口等優勢：

- **家電領域。**AI-MCU賦能冰箱、空調、控制面板等設備，實現顯示、手勢識別、語音識別等多模態人機交互。
- **工業控制領域。**AI-MCU支持小型機械臂的運動控制和視覺引導系統，實現實時數據採集與控制，並通過CAN網絡實現設備互聯。
- **醫療應用領域。**AI-MCU為便攜式健康監測設備提供算力，執行傳感器數據融合和低功耗端側AI推理，在持續在線的傳感模式下表現突出，可確保持續可靠運行。

模擬芯片

LED驅動芯片

在汽車應用領域，我們提供廣泛的LED驅動器與電源管理芯片，支持4.5V至70V的電壓範圍及450mA至6A的輸出電流。該等芯片廣泛應用於車外照明系統（如前大燈、尾燈、剎車燈、轉向燈、霧燈等）及車內照明系統（如氛圍燈、閱讀燈、座椅燈、指示燈及迷你LED屏幕背光）。在非汽車市場，我們的LED驅動器應用於高端遊戲設備（如遊戲鼠標、鍵盤及電腦機箱的RGB燈）與家居設備（如音箱、掃地機器人及家用電

業 務

器中的呼吸燈)。該系列芯片支持PWM調光、消鬼影等先進功能，同時滿足功能性與美觀性需求。

Combo芯片

為滿足對緊湊集成設計日益增長的需求，我們亦提供集MCU、LED驅動器、觸覺傳感器及LIN/CAN bus於一體的Combo芯片，以支持氛圍燈、觸控應用，如門把手或面板。憑藉我們在模擬技術領域的專業知識，我們提供可滿足多應用場景要求的全面多元化產品組合，確保可靠性、高效能及可擴展性。

季節性

我們產品的需求及銷售通常遵循搭載我們產品的終端產品的季節性趨勢，不同產品類別和市場存在差異。

產品定價

作為芯片設計公司，我們的定價策略與半導體行業固有週期性及供需動態緊密相連，請參閱「財務資料－影響我們經營業績的重大因素－行業週期」。除行業趨勢外，我們的定價亦綜合考慮產品開發與製造成本、市場競爭、客戶關係、訂單規模及目標利潤率等因素。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，概無政府監管定價指引適用於我們。

對於標準化、廣泛應用的產品，我們採用市場導向定價策略，在保持合理盈利能力的同時確保競爭力。對於技術先進且具差異化的產品，定價則體現其更高的價值和技術複雜性，與我們實現豐厚投資回報的目標相一致。在價格競爭激烈的市場，我們可能策略性地調整定價，以優先實現市場份額增長、銷量擴張或其他長期目標。

此外，對於車規級芯片等產品，我們會詳細分析市場趨勢、競爭性定價和銷售預測，以確保產品生命週期內的可持續盈利能力。通過平衡成本考量與市場動態，我們致力於提供既滿足客戶需求又符合業務目標的競爭性定價。

研發

研發對維持我們的競爭地位及推動業務長期增長至關重要，使我們能夠滿足下游應用不斷變化的需求。我們已實施IPD框架，即系統性的研發管理模式，將產品開發視為一項戰略投資決策。該框架以市場需求為支撐，透過跨部門協作以實現商業成功，將我們的產品業務線整合為一個連貫的研發流程。

業 務

該結構化工作流程及分階段決策機制可有效縮短我們產品的上市時間並降低研發成本。具體而言，逐步進行的審查可降低中途出現戰略失準或設計錯誤的風險。同時，通過採用異步發展與並行工作實踐，我們得以同步推進並執行下游任務，包括封裝、測試及系統解決方案開發。此外，市場營銷、生產及供應鏈團隊的早期參與可確保及早識別潛在的製造或商業障礙，從而最大程度減少下游營運摩擦、降低昂貴的設計返工，並提升整體研發效率。

我們的研發聚焦於產品核心IP自主開發，同時策略性地整合成熟授權IP，增強技術能力並優化產品性能。研發開支於進行活動的期間確認為已產生及支銷，除非其根據相關會計準則滿足資本化標準則除外。

關鍵技術

經過多年的持續投入，我們已逐步在以下領域構建起專有關鍵技術：

嵌入式CPU。多年以來，我們一直進行嵌入式CPU技術研發，在高性能低功耗等關鍵指標上實現重大突破。自主研發的XBurst系列CPU內核，基於32位MIPS指令集架構設計，採用創新性微體系結構。在相同工藝節點下，該系列內核在頻率、能效及芯片面積方面均達到同類型32位RISC微處理器內核的行業領先水平。自2014年起，我們積極採用RISC-V開源指令集架構，研發推出Victory系列CPU內核。目前，自研的RISC-V CPU內核已在計算芯片產品線中實現部署應用。

VPU。我們開發了一系列支持主流視頻格式（如H.264、H.265）的視頻編解碼器。通過對關鍵編碼路徑的算法與硬件協同優化，並採用精細化門控技術，在提升性能的同時降低動態功耗。我們的產品在性能、面積及功耗方面均達到行業領先水平，為我們在智能視覺領域的業務拓展提供強有力支撐。

ISP。我們自主研發的ISP技術持續向行業領先標準邁進，具備2D/3D降噪、寬動態範圍、自動抗頻閃、噪聲建模等核心算法。這些技術為各種複雜光照環境下的成像提供穩定、高質量的成像基礎。

AI-ISP。我們將自研的NPU與ISP管線深度融合，採用神經網絡算法替代傳統圖像處理方法。借助AI技術，旨在實現自適應降噪、動態範圍增強及細節重建，顯著提升圖像的客觀質量指標與主觀視覺體驗。

NPU。我們持續投入NPU技術的研發。依託我們在自研CPU技術方面的優勢，我們構建了獨特的NPU架構，將CPU與神經網絡加速單元進行有機整合。我們的自

業 務

研NPU在高計算性能與靈活性之間實現平衡，既支持傳統卷積神經網絡加速的可編程性，亦能高效運行大規模AI模型。先進的低比特量化技術進一步增強了NPU的低功耗、低帶寬AI算力，可根據不同的計算需求與應用場景在不同精度級別下實現可擴展性能。

AI開發平台。為覆蓋多元化的AI應用場景，我們研發了涵蓋模型訓練、優化、轉換及推理部署全流程的深度神經網絡開發平台。該平台包含主流框架的模型訓練插件、模型優化與轉換工具鏈以及推理固件庫。其提供豐富的預訓練模型庫（涵蓋圖像識別、語音處理、大模型等領域）與自主算法。憑藉端到端工具鏈支持，開發者可快速實現從模型開發到端側部署的最新AI技術落地，大幅縮短產品上市週期。

AI算法。我們在AI算法研發與應用領域投入大量資源，已推出人臉識別、車牌識別、嬰兒哭聲檢測、人體檢測與跟蹤、多目標檢測、口罩檢測等成熟產品。我們持續優化量化工具與訓練插件，簡化低比特模型開發流程，加速算法迭代速度。隨著AI算法技術與平台開放性的不斷成熟，我們的軟硬件協同設計能力持續提升，為算法創新提供快速反饋與迭代支持。

存儲技術。憑藉三十餘年在存儲技術領域的深厚積累，我們在DRAM、SRAM及NOR Flash技術方面構建了全面的技術體系。核心技術能力涵蓋先進存儲單元設計、高速低功耗電路架構、工藝優化、可靠性工程及高魯棒性糾錯技術等。這些技術能力使我們能夠研發出高性能高可靠性的存儲芯片，可滿足汽車電子、工業控制及醫療設備等要求嚴苛的應用領域。

模擬技術。我們的模擬技術涵蓋多領域創新，包括高精度模擬電路設計、高效電源管理、先進LED驅動器架構、照明控制與燈效算法，以及適用於LIN與控制器局域網協議的高魯棒性通信接口解決方案。在低噪聲、高精度、高集成度的模擬及混合信號設計方面，我們積累了豐富經驗，能夠滿足汽車電子、工業及家電等領域的複雜需求。

研發團隊及開支

截至2026年3月31日，我們有822名研發人員，佔截至同日我們僱員總數的65.7%。彼等以高學歷背景、專業素養及豐富的項目開發經驗見稱。截至2026年3月31日，我們約95.1%的研發僱員持有學士或以上學位。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們的研發開支分別為人民幣708.3百萬元、人民幣681.3百萬元、人民幣712.0百萬元及人民幣171.9百萬元，佔我們於各年度／期間總收入的15.6%、16.2%、15.0%及11.0%。

為確保我們研發能力的長期可持續性，我們已制定一套全面的研發戰略，並配備專項財務資源分配。儘管於往績記錄期間我們的歷史研發開支佔收入的百分比因收入迅速擴張及規模經濟效應而輕微下降，但我們研發投資的絕對數額仍然十分強勁。我們計劃通過系統性地招聘全球研發人才、購置先進研發設備，以及深化與上下游行業合作夥伴的技術合作，來執行該戰略。具體而言，在我們的存儲芯片板塊，我們將投資於先進的存儲技術，包括3D DRAM及安全NOR Flash，以捕捉汽車電子及端側AI

業 務

領域的結構性機遇。同時，在我們的計算芯片板塊，我們計劃優化自主RISC-V CPU架構、NPU及端側AI算法，以擴充我們的智能視覺SoC及AI-MCU產品組合。此外，在我們的模擬芯片板塊，我們將專注於擴充我們的高可靠性、車規及工業級LED驅動及Combo芯片產品組合，以捕捉車輛電動化及工業自動化帶來的市場需求。通過該等舉措，我們認為，我們將能夠維持並進一步提升我們的核心研發能力。

銷售及營銷

我們的產品銷往亞洲、美洲及歐洲約50個國家和地區的下游客戶。為進一步擴大我們的全球影響力，我們組建了一支由銷售及營銷專業人員以及工程師組成的國際化團隊，為我們的銷售及服務網絡提供本地化支持。該團隊擅長獲取市場實時動態並據此採取行動，確保及時有效地響應客戶需求。

我們的產品主要通過經銷商銷售；然而，我們亦應要求向若干客戶提供直銷。我們相信，始終如一地按時交付高質量產品，同時滿足並超越客戶的期望，是實現銷售及營銷成功的最有效途徑。因此，我們致力於維持及拓展與直接及間接客戶的戰略關係。

在我們的綜合產品開發框架下，我們的銷售團隊積極參與產品研發流程，以確保我們的產品滿足客戶的特定需求。這種協作模式使我們能夠提供符合多元化客戶群期望的產品，同時保持高標準的質量及滿意度。

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
(人民幣千元，百分比除外)										
(未經審計)										
經銷										
購銷.....	3,143,088	69.4%	2,940,396	69.8%	3,436,650	72.4%	737,672	69.6%	1,153,578	74.0%
代銷.....	421,405	9.3%	338,185	8.0%	334,567	7.1%	79,556	7.5%	110,998	7.1%
經銷小計	3,564,493	78.7%	3,278,581	77.8%	3,771,217	79.5%	817,228	77.1%	1,264,576	81.1%
直銷.....	966,433	21.3%	934,045	22.2%	969,791	20.5%	243,004	22.9%	295,191	18.9%
總計.....	4,530,926	100.0%	4,212,626	100.0%	4,741,008	100.0%	1,060,232	100.0%	1,559,767	100.0%

業 務

經銷

通常情況下，我們的銷售團隊會直接與潛在買家接觸，以了解其具體需求。在找到潛在買家後，我們通常會與當地經銷商合作銷售我們的產品，除非買家另有特別要求。該方法提供了幾個戰略優勢：

- **擴大市場覆蓋範圍：**與擁有廣泛銷售渠道的經銷商合作，使我們能夠開拓更廣闊的市場，因為該等經銷商可利用其網絡尋找客戶並有效滿足區域需求。
- **優化現金流：**經銷商通常需預付貨款，這有助於增強我們的現金流並降低財務風險。
- **運營效率：**通過外包客戶引流及客戶關係管理方面的工作，我們減輕了內部銷售團隊的工作量。此外，經銷商管理存貨及處理交付，簡化了物流並降低了運營負擔，從而實現更快速高效的訂單履行。
- **售後服務：**經銷商可利用其已建立的網絡向客戶提供售後服務，而我們則在需要時向終端用戶提供技術支持。

根據弗若斯特沙利文的資料，採用經銷模式符合行業規範。我們與經銷商維持買賣關係，產品所有權於經銷商購買後轉讓予經銷商。我們向經銷商的銷售屬經常性性質。有關我們透過經銷商銷售的相關收入確認政策，請參閱「附錄一——會計師報告」附註4。

我們的經銷商通常為專門從事半導體及電子元件銷售及經銷的公司，使彼等處於有利地位以支持我們客戶的需求並促進我們的業務增長。

經銷商管理

為應對不同客戶與供應場景，我們採用兩種經銷模式經營。在購銷（渠道銷售）模式下，產品交付時所有權與風險即轉移至經銷商，且收入於出貨予經銷商時確認。在代銷模式下，產品存放於經銷商，惟所有權仍歸我們所有，直至經銷商將產品售予終端客戶時為止，於該時間點方確認收入。

我們使用各模式的情形

購銷模式是我們日常補貨與寬渠道經銷的默認模式。我們選擇性採用代銷模式，以支持需要保證供應、更精準需求預測或協調上市進程的項目，例如新平台推出、長週期汽車／工業項目，或季節性影響明顯的區域。此舉旨在緩解渠道堵塞風險，並使存貨與確認消耗量保持一致。代銷模式通過消除經銷商過量訂購的動機，將補貨與實際終端銷售數據而非囤貨情緒掛鉤，從而支持實現這一目標。

業 務

於往績記錄期間，我們部分存儲及模擬芯片乃通過代銷方式出售。儘管商品實際交付予經銷商，但其在終端銷售前仍為我們的存貨，收入於終端銷售時予以確認。由於在終端銷售前所有權並無轉移，但我們超量出貨並無增加收入或經銷商的存貨。

代銷方式下的控制及管治

為將備貨及補貨與經核實的需求掛鉤，我們的銷售團隊與經銷商合作確認下游需求（包括數量與目標定價），並驗證提貨量。庫存釋放以終端客戶採購訂單或同等確定訂單積壓為門檻，且須遵守協定的覆蓋範圍門檻。經銷商定期提供終端銷售與賬齡報告，我們據此調整庫存上限與補貨頻率。

代銷方式適合存儲及模擬芯片的原因

存儲及模擬芯片涉及多元化規格及多個SKU，尤其是在汽車及工業市場，在該等市場可能產生滯銷存貨。經銷商審慎持有存貨，因為我們不接受未售滯銷存貨退貨。代銷方式確保了銷售點的供應，而並無轉讓所有權，從而防止渠道庫存過剩。

商業條款

除所有權轉移及收入確認時間外，代銷模式下經銷協議的其他商業條款（包括定價模式及經銷商薪酬）與我們的標準經銷商協議一致。

我們維持嚴格的經銷商遴選流程，以確保彼等符合我們的標準並與我們的戰略目標保持一致。例如，我們可能會考慮以下因素：

- 經銷商的綜合背景，包括其資質、業務規模、行業經驗、本地網絡、地域銷售覆蓋、客戶服務能力及技術支持能力。
- 產品的協同性，確保與其現有產品組合無衝突，並挖掘可以提升客戶解決方案的潛在協同作用。
- 彼等提供綜合解決方案的能力，該等解決方案結合了不同的產品，以滿足多樣化的客戶需求。
- 彼等的系統管理能力，包括完善的數據基礎設施、健全的CRM系統及先進的銷售分析工具。

為維持管控並確保質量，我們禁止經銷商發展次級經銷商，詳情載於我們與經銷商訂立的協議。據董事所深知，於往績記錄期間，我們的所有經銷商均為獨立第三方，且於往績記錄期間，概無經銷商受我們任何前任或現任僱員控制。

業 務

我們並未向經銷商設定銷售目標或最低採購要求。我們定期評估彼等的表現，以決定是否與彼等重續協議。評估考慮了彼等過往銷售我們的產品、付款記錄、遵守經銷協議、售後能力以及銷售及營銷表現等因素。

儘管經銷商負責管理其本身的存貨，我們仍鼓勵彼等根據其實際及預測需求下單。為提升市場需求預測的準確性，我們要求經銷商提交銷售預測。在銷售出現大幅波動或偏離預測的情況下，我們可能會直接與終端客戶核實需求，並根據需要調整訂單。此外，我們與經銷商保持密切溝通，並可能於必要時要求彼等提供存貨記錄。產品一經交付並經經銷商驗收，除涉及質量問題的情況外一般不予退換。

我們的經銷商通常被授予非獨家權利，以在其協議規定的特定經銷區域內銷售我們的產品。若經銷商違反該等區域規定，我們一般保留提前30天發出書面通知以終止協議的權利。關於定價，我們通常為我們的產品提供建議零售價，但我們的經銷商仍可自主制定定價策略。

我們依據客戶信貸管理實務進行全面評估，以決定是否授予經銷商信貸條款。關鍵考量因素包括經銷商的財務實力及流動性（例如經審計業績及槓桿比率）、與我們往來的付款紀錄及合作實績、其下游需求及客戶群的穩定性及可預測性、預期交易量及訂單的持續性，以及該客戶或項目的戰略重要性。我們亦考量產品特性及交貨期、季節性銷售模式，以及經銷商的庫存水平。當風險指標較高時，我們可能縮短付款期限、要求部分預付款或抵押品、設定信貸額度，或恢復全額預付款；若風險較低且訂單可預測性較高，則可能將付款期限延長至30至90天範圍內。該等評估將定期進行審查，並可能根據經銷商營運狀況及表現的變化而調整。

我們通過經銷協議與經銷商建立正式關係，經銷協議會視乎與個別經銷商的磋商結果而異。該等協議確保了明確的合作框架，同時保持靈活性，以適應特定情況。

下表載列我們經銷協議的主要條款：

期限 : 一般為一年，倘我們對經銷商的評估結果滿意，則會自動續期一年。

支付及信貸期 : 我們通常要求經銷商預付貨款。根據我們的客戶信貸管理政策，我們可能向若干經銷商提供信貸期，視乎彼等的經營狀況、財務狀況及預期交易量而定。

產品交付 : 我們負責將產品交付至訂單中指定的地點給經銷商或指定收貨方。

業 務

- 風險轉移** : 當我們將產品交付至協定地點或收貨方後，風險即轉移至經銷商。
- 退貨／換貨** : 除產品質量問題外，我們一般不接受退貨或換貨。若終端產品發生故障，且該故障非因我們的產品或規格、設計或製造缺陷所致，亦非因我們違反適用的保證條款或法律所致，我們概不承擔產品責任。
- 產品銷售** : 我們的經銷商僅獲准在指定區域內銷售我們的產品。
- 定價** : 我們產品的售價將按經銷商所下訂單另行協定。
- 終止** : 根據協議的實際條款，協議的任何一方都有權在提供事先書面通知後單方面無理由終止協議。倘任何一方在接獲另一方書面通知後30天內未能履行或遵守協議項下的任何義務，或進入破產、清算、接管或任何其他表明資不抵債或無法履行其義務的情況，則另一方可立即終止協議。協議終止不應影響任何一方支付本協議項下應付予另一方的任何款項的義務，所有該等款項到期時仍應支付。

下表載列我們的經銷商總數及其於往績記錄期間的變動。

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
年／期初經銷商				
數目	127	131	133	137
新經銷商數目	4	2	4	1
終止經銷商數目	—	—	—	—
年／期末經銷商				
數目	131	133	137	138

業 務

避免經銷商之間競爭

我們主要透過劃定銷售區域、監控機制及符合現行慣例的定價指引來管理內部競爭。經銷商乃以非獨家方式委任，但依據我們的經銷協議，將獲分配特定地理區域。我們監督經銷商的表現及市場覆蓋範圍，以及早識別業務重疊區域，並於必要時採取糾正措施，包括執行協議項下的區域要求。

為管理經銷商間的定價，我們提供建議零售價以促進價格一致性，並抑制破壞性價格競爭，同時經銷商仍保有定價彈性。當我們觀察到銷售額出現顯著波動，或與預測值存在重大偏差（可能暗示渠道衝突或內部競爭現象時），我們或會向終端客戶核實需求狀況，並適時調整經銷商訂單。我們亦監督庫存水平及預測數據，使出貨量與需求保持一致，此舉有助於降低各渠道間相互壓價的誘因。

對於在特定區域內不具獨家經銷權的經銷商，我們透過區域劃分、持續表現監控、建議定價，以及在出現重大偏離時介入干預相結合的措施，旨在限制內部競爭及維持市場秩序。經銷商收到的產品通常不可退貨，除非存在質量問題，其進一步抑制了投機性囤貨行為及價格驅動的衝突。基於該等措施，我們旨在平衡市場覆蓋及競爭，同時將銷售渠道間的內部競爭降至最低。

為盡量減少我們經銷商之間的競爭，我們採取多項積極措施，以確保建立均衡協作的經銷網絡。我們根據特定地理區域分配非獨家經銷權，並明確界定各經銷商經營的區域。這有助於經銷商專注發展彼等指定的市場，而不會與其他經銷商重疊。該等區域安排透過我們的經銷協議嚴格執行，倘經銷商違反該等規定，我們可終止協議。

為維持公平的市場覆蓋範圍，我們會定期監察及評估經銷商的表現。這使我們能夠及早識別潛在衝突或業務重疊，並採取糾正措施，以防止同一客戶群內出現過度競爭。我們亦會向經銷商提供建議零售價，以促進定價一致性及避免破壞性價格戰。儘管經銷商在自行定價方面仍具靈活性，該等指引有助維持穩定的市場環境。

通過要求經銷商提交銷售預測並密切監控其存貨水平，我們可將其業務活動與實際市場需求保持一致。我們並無設定經銷商的最低採購額，並鼓勵其按實際及預測需求滾動下單。如銷售有重大波動，或嚴重偏離其所預測者，我們可能接洽終端客戶核實實際需求及相應調整經銷商訂單。此外，產品一經交付並由本公司的經銷商接納，則除質量問題外不得退換貨。

通過該等措施，我們建立了一個協作型經銷網絡，以最大限度地減少衝突並確保所有相關方實現可持續增長。本公司與經銷商保持密切溝通。

業 務

渠道存貨控制

我們通過將經銷商終端銷售報告及訂單積壓與生產及交付計劃進行對賬，並將關鍵產品的出貨與已確認的設計導入及客戶生產提產相掛鉤，以使出貨與最終市場需求保持一致。我們按照既定的交付前置期及最低訂單政策接受訂單，對於汽車及工業產品，一般採取不可取消及不可退貨的條款，以防止投機性採購。我們透過經銷商提供的存貨及賬齡概況定期監督渠道健康，當存貨接近內部安全水平時，會相應調整出貨節奏。基於上述安排，董事認為，我們的銷售反映終端客戶的實際需求。

我們的經銷商安排包括(i)購銷（渠道銷售）安排，根據該安排，所有權及風險於交付時轉移至經銷商；及(ii)代銷安排，根據該安排，所有權仍歸屬於我們，直至經銷商將商品售予終端客戶為止。

就代銷安排而言，經銷商實際持有但尚未售出的產品，在終端銷售前仍列為我們的存貨。就購銷安排而言，未售出存貨列於經銷商的資產負債表上，且未以標準化、可審計的基準向我們報告。因此，我們並不知悉經銷商根據購銷安排將產品轉售予終端消費者所需的平均時間。我們亦無與於往績記錄期間各年／期末經銷商所持有未售出存貨數量相關的資料。

根據獨家保薦人進行的獨立盡職調查及本公司向獨家保薦人提供的資料及陳述，獨家保薦人未發現任何可能導致其任何重大方面與董事意見相左的事項。

直銷

我們通常與主要客戶訂立框架協議，實際價格及數量以個別採購訂單為準。該等協議的條款視乎特定產品或項目及我們與各客戶的磋商結果而有所不同，但該等協議一般包含以下條款：

- 期限.....：一般為一年，另有協定的除外。
- 定價.....：我們產品的售價將按客戶所下訂單另行協定。
- 風險轉移.....：當客戶驗收產品後，風險即轉移至客戶。
- 支付及信貸期.....：我們通常要求客戶預付貨款。根據我們的客戶信貸管理政策，我們可能向若干客戶提供介乎30天至90天的信貸期，視乎彼等的經營狀況、財務狀況及預期交易量而定。
- 最低購買要求.....：我們與客戶的框架協議通常不包含最低購買要求。

業 務

- 產品交付** : 我們一般負責將產品交付至客戶所下訂單指定的地點及時間。
- 退貨／換貨** : 我們的客戶一般有關退回或更換未達質量或規格要求的產品。若終端產品發生故障，且該故障非因我們的產品或規格、設計或製造缺陷所致，亦非因我們違反適用的保證條款或法律所致，我們概不承擔產品責任。
- 保密性** : 該等框架協議通常載有嚴格的保密條款，限制協議各方披露任何機密資料。
- 終止** : 該等框架協議可經各方協商同意後終止，或在若干情況下（如未補救的重大違約、不可抗力或一方破產）被單方面終止。

我們的客戶

我們的客戶為經銷商及直銷客戶，主要包括電子元件製造商及經銷商。製造商為設計及生產內部電子系統及設備所用部件及其自我們採購的產品（包括存儲芯片、微控制器／SoC、模擬芯片及電源管理芯片）的公司。經銷商為主要負責商業化及經銷而非生產該等部件的公司。

五大客戶

於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們向五大客戶的銷售額分別為人民幣2,470.4百萬元、人民幣2,187.6百萬元、人民幣2,406.0百萬元及人民幣784.9百萬元，分別佔我們於各年度／期間總銷售額的54.5%、51.9%、50.7%及50.3%。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們向最大客戶的銷售額分別為人民幣953.7百萬元、人民幣817.3百萬元、人民幣812.5百萬元及人民幣243.2百萬元，分別佔我們於各年度／期間總銷售額的21.0%、19.4%、17.1%及15.6%。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，據董事所深知，概無董事、彼等的聯繫人或任何現有股東（據董事所知，彼等擁有我們5%以上的股本）於往績記錄期間的任何期間於我們五大客戶中擁有任何根據上市規則須予披露的權益。

業 務

下表載列於所示年度／期間有關我們五大客戶的若干資料。

截至2026年3月31日止三個月

	客戶	交易金額 (人民幣千元)	收入佔比 %	合作期限 (年)	售出的主要產品	信貸期	銷售類型
1...	客戶A ⁽¹⁾	243,202	15.6	22	存儲芯片	45天內	經銷
2...	客戶B ⁽²⁾	193,153	12.4	17	存儲芯片	60天內	經銷
3...	客戶C ⁽³⁾	160,995	10.3	8	計算芯片	30天內	經銷
4...	客戶D ⁽⁴⁾	116,930	7.5	7	計算芯片	30天內	經銷
5...	客戶E ⁽⁵⁾	70,601	4.5	17	存儲芯片	60天內	經銷

截至2025年12月31日止年度

	客戶	交易金額 (人民幣千元)	收入佔比 %	合作期限 (年)	售出的主要產品	信貸期	銷售類型
1...	客戶A	812,542	17.1	22	存儲芯片	45天內	經銷
2...	客戶B	561,414	11.8	17	存儲芯片	60天內	經銷
3...	客戶C	527,837	11.1	8	計算芯片	30天內	經銷
4...	客戶D	354,802	7.5	7	計算芯片	30天內	經銷
5...	客戶E	149,501	3.2	17	存儲芯片	60天內	經銷

截至2024年12月31日止年度

	客戶	交易金額 (人民幣千元)	收入佔比 %	合作期限 (年)	售出的 主要產品	信貸期	銷售類型
1...	客戶A	817,289	19.4	22	存儲芯片	45天內	經銷
2...	客戶C	443,508	10.5	8	計算芯片	30天內	經銷
3...	客戶B	438,986	10.4	17	存儲芯片	60天內	經銷

附註：

- (1) 客戶A從事科技產品經銷及供應，總部位於美國。其股份於紐約證券交易所上市。我們與客戶A的合作年期，乃參考客戶A與我們的附屬公司ISSI（於1988年註冊成立）之間的業務關係存續時間計算，有關業務關係於本公司成立前已開始。在成為本集團成員公司之前，ISSI已與客戶A建立並維持業務關係，我們在收購ISSI後繼續進行該項合作。
- (2) 客戶B從事採購和工程技術解決方案，總部位於美國。其母公司的股份於紐約證券交易所上市。
- (3) 客戶C從事芯片、電子元件和模塊代理銷售，總部位於中國深圳。
- (4) 客戶D從事電子產品開發、生產及經銷，總部位於中國深圳。
- (5) 客戶E為一家工業及汽車芯片以及物聯網解決方案的私營供應商，總部位於香港。

業 務

	客戶	交易金額 (人民幣千元)	收入佔比 %	合作期限 (年)	售出的 主要產品	信貸期	銷售類型
4...	客戶D	366,029	8.7	7	計算芯片	30天內	經銷
5...	客戶F ⁽⁶⁾	121,791	2.9	18	存儲芯片	75天內	直銷

截至2023年12月31日止年度

	客戶	交易金額 (人民幣千元)	收入佔比 %	合作期限 (年)	售出的 主要產品	信貸期	銷售類型
1...	客戶A	953,688	21.0	22	存儲芯片	45天內	經銷
2...	客戶B	514,585	11.4	17	存儲芯片	60天內	經銷
3...	客戶D	468,267	10.3	7	計算芯片	30天內	經銷
4...	客戶C	421,499	9.3	8	計算芯片	30天內	經銷
5...	客戶G ⁽⁷⁾	112,292	2.5	超過5	存儲芯片	30天內	經銷

客戶投訴

我們已制定全面的客戶投訴政策及處理程序，以確保及時有效解決任何客戶疑慮。於整個往績記錄期間，我們維持透明溝通渠道及專責支持團隊根據我們的內部手冊解決客戶反饋。於往績記錄期間，我們並無收到任何重大客戶投訴。

生產、採購、存貨及物流

我們的無晶圓廠模式

我們並不直接製造產品。相反，我們採用無晶圓廠模式，即與優質生產合作夥伴合作完成製造流程的所有階段。該模式使我們能夠將資源集中於芯片設計、平台開發及市場導向的創新，同時與領先的晶圓廠及封測代工供應商合作，確保可擴展性及高質量產品。此外，無晶圓廠模式使我們能夠避免與擁有及營運各種晶圓製造、封裝及測試設施相關的許多重大成本及風險。截至2026年3月31日，我們與18家優質晶圓廠合作夥伴緊密合作進行芯片製造，並與28家封測代工合作夥伴進行芯片封裝及測試。

除芯片設計外，我們投入資源開發針對我們產品優化的生產工藝，並合作建立適合我們產品的可製造性設計(DFM)及可靠性設計(DFR)規則，從而實現工藝設計與製造的強大整合能力。通過分享行業見解、技術交流及協同定制開發，我們推動架構升級及工藝技術演進與創新等上游產業進步，從而獲得供應鏈的優先及全面支持。

(6) 客戶F從事半導體、動力總成和電動汽車相關產品供應，總部位於德國蓋林根。

(7) 客戶G從事電子元件經銷，總部位於中國台灣。

業 務

我們的晶圓廠合作夥伴負責採購用於生產我們芯片的原材料。當我們的晶圓廠合作夥伴完成晶圓的製造後，根據相關協議，晶圓廠合作夥伴或我們負責將晶圓運送至我們的封測代工合作夥伴進行切割、封裝及測試。進一步詳情請參閱「一 物流」。

於往績記錄期間，整個行業對芯片產品的需求已不同程度地轉向AI驅動應用。於該等期間，我們並未遭遇任何對我們的營運或財務表現造成重大不利影響的重大供應鏈瓶頸或中斷，且根據我們與晶圓廠及封測代工合作夥伴的安排，我們並未違約或遭遇任何違約。憑藉我們與多元化的晶圓廠及封測代工合作夥伴的長期關係，加上與若干主要晶圓廠合作夥伴訂立的長期產能綁定安排，我們於往績記錄期間能夠獲得充足的晶圓供應及封裝測試產能，以滿足我們的生產需求。因此，於往績記錄期間，該等需求轉變並未對我們的營運或經營業績造成任何重大影響。

與我們生產合作夥伴的安排

生產合作夥伴的遴選

我們審慎遴選我們的生產合作夥伴，並根據多項因素對彼等進行評估，包括整體往績記錄、技術專長、產品質量及質量控制效能、價格、可靠性、能否滿足我們交付時間的能力、地點、物流及生產能力。我們與優質晶圓廠合作夥伴及封測代工合作夥伴合作，據此，我們相信這能保障芯片的質量。

芯片製造

為促進我們的晶圓廠合作夥伴分配其生產資源，我們應其要求提供生產計劃。實際採購的條款及條件（包括芯片的定價、數量及規格）於個別採購訂單中訂明。

我們採用無晶圓廠模式，並仰賴合格的晶圓廠合作夥伴採購用於芯片製造的原材料，例如矽晶圓、光阻劑、氣體、化學品及金屬。為確保該等投入材料及最終晶圓的質量，我們實施分層管控機制，涵蓋合作夥伴資格認證、規格控制及持續監管。

封裝及測試

我們通常按月與封測代工合作夥伴結算。

業 務

我們的供應商

我們的供應商主要為進行芯片製造的晶圓廠合作夥伴以及進行芯片測試及封裝的封測代工合作夥伴。

我們一般與主要晶圓廠及封測代工合作夥伴訂立框架協議，並於個別採購訂單中訂明實際價格及數量。該等協議的條款視乎特定產品或項目及我們與各供應商的磋商結果而有所不同，但該等協議一般包含以下條款：

- 期限** : 晶圓廠的期限一般為三至五年，封裝及測試協議的期限為三年，另有協定的除外。
- 參與方的主要權利及義務** : 我們向晶圓廠合作夥伴提供產品參數、技術規範、生產工藝要求及其他產品要求。我們的晶圓廠合作夥伴會根據我們的要求製造晶圓產品。我們向按照我們的要求提供封裝及測試服務的封裝及測試服務提供商提供晶圓產品及技術規範。
- 支付及信貸期** : 我們根據採購訂單或協議中訂明的條款付款。我們的晶圓廠合作夥伴通常授予我們一個月的信貸期，而我們的封測代工合作夥伴則授予我們一至兩個月的信貸期。
- 產能安排** : 就特定節點及封裝而言，我們的供應協議可能包括與滾動預測掛鉤的產能承諾。通常會在供應商交付前置期內確定近期預測晶圓投片或封裝單位部分，並由供應商保留相應產能。在協定限額內，我們可調整產品組合或數量；超出限額的變動可能產生費用。在供應緊張期間，我們可能同意採取預留產能或照付不議條款以確保優先供應，若未實現產能，將有相應救濟措施。該等承諾以供應商符合質量及交付要求為前提。
- 質量保證** : 晶圓廠及封測代工合作夥伴需要交付符合我們特定質量要求及產品規格的產品。
- 退貨** : 若因供應商的過失導致產品不符合我們的產品質量要求或規格，我們有權拒絕、更換或退回有關產品。
- 終止** : 任何一方均有權根據協議訂明的條款（包括重大違約）終止協議。

業 務

前五大供應商

於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們向五大供應商的採購額分別為人民幣1,701.0百萬元、人民幣1,423.3百萬元、人民幣1,555.1百萬元及人民幣430.4百萬元，分別佔我們於各年度／期間總採購額的58.3%、47.8%、45.1%及41.6%。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們向最大供應商的採購額分別為人民幣773.9百萬元、人民幣350.4百萬元、人民幣479.7百萬元及人民幣126.6百萬元，分別佔我們於各年度／期間總採購額的26.5%、11.8%、13.9%及12.3%。於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，據董事所深知，概無董事、彼等的聯繫人或任何現有股東（據董事所知，彼等擁有我們5%以上的股本）於往績記錄期間的任何期間於我們五大供應商中擁有任何根據上市規則須予披露的權益。

下表載列於往績記錄期間有關我們前五大供應商的若干資料。

截至2026年3月31日止三個月

	供應商	交易金額 (人民幣千元)	購買量佔比 %	合作期限 (年)	向我們提供的主要 產品／服務	信貸期
1	供應商A ⁽¹⁾	126,584	12.3	超過8	晶圓	30天內
2	供應商C ⁽²⁾	95,219	9.2	超過3	封裝及測試	60天內
3	供應商D ⁽³⁾	75,888	7.3	超過3	晶圓	30天內
4	供應商J ⁽⁴⁾	66,633	6.4	超過18	晶圓	30天內
5	供應商B ⁽⁵⁾	66,054	6.4	超過12	晶圓	30天內

(1) 供應商A從事半導體製造，總部位於中國台灣。其股份於台灣交易所上市。

(2) 供應商C從事半導體封裝及測試服務，總部位於中國台灣。其股份於台灣交易所上市。

(3) 供應商D為一家從事NAND Flash控制芯片設計及存儲解決方案的公司，總部位於中國台灣。其股份於台灣交易所上市。

(4) 供應商J為一家從事半導體製造的公司，總部位於上海。其母公司的股份於上海證券交易所及香港交易所上市。

(5) 供應商B為一家從事半導體製造的公司，總部位於中國武漢。

業 務

截至2025年12月31日止年度

	供應商	交易金額 (人民幣千元)	購買量佔比 %	合作期限 (年)	向我們提供的 主要產品／ 服務	信貸期
1	供應商A	479,740	13.9	超過8	晶圓	30天內
2	供應商I ⁽⁶⁾	320,244	9.3	超過1	晶圓	15天內
3	供應商C	296,712	8.6	超過3	封裝及測試	60天內
4	供應商B	252,822	7.3	超過12	晶圓	30天內
5	供應商E ⁽⁷⁾	205,711	6.0	超過8	晶圓	30天內

截至2024年12月31日止年度

	供應商	交易金額 (人民幣千元)	購買量佔比 %	合作期限 (年)	向我們提供的 主要產品／ 服務	信貸期
1	供應商A	350,359	11.8	超過8	晶圓	30天內
2	供應商B	346,812	11.6	超過12	晶圓	30天內
3	供應商E	316,201	10.6	超過8	晶圓	30天內
4	供應商F ⁽⁸⁾	207,367	7.0	超過14	晶圓	30天內
5	供應商C	202,491	6.8	超過3	封裝及測試	60天內

截至2023年12月31日止年度

	供應商	交易金額 (人民幣千元)	購買量佔比 %	合作期限 (年)	向我們提供的 主要產品／ 服務	信貸期
1	供應商A	773,931	26.5	超過8	晶圓	30天內
2	供應商B	448,482	15.4	超過12	晶圓	30天內
3	供應商C	190,029	6.5	超過3	封裝及測試	60天內
4	供應商F	161,466	5.5	超過14	晶圓	30天內
5	供應商G ⁽⁹⁾	127,134	4.4	超過2	封裝及測試	60天內

(6) 供應商I為一家從事DRAM製造的私營公司，總部位於香港。

(7) 供應商E為一家跨國半導體合約製造及設計公司，總部位於美國。其股份於納斯達克全球精選市場上市。

(8) 供應商F從事半導體製造，總部位於中國台灣。其股份於台灣交易所上市。

(9) 供應商G從事半導體封裝及測試，總部位於中國上海。其母公司的股份於台灣交易所上市。

業 務

重疊的供應商及客戶

於往績記錄期間，我們的主要客戶及主要供應商之間並無任何重疊。

存貨管理政策

我們建立一套結構化的存貨管理框架，旨在平衡供應保障與營運資金效率。請參閱「財務資料－選定資產負債表項目－存貨－存貨管理政策」。

物流

晶圓廠合作夥伴或我們負責將晶圓從晶圓廠運送至測試及封裝設施。我們負責將經過封裝測試的芯片運送至我們的經銷商或直銷客戶指定的地點或接收人。

我們委聘合資格第三方物流服務提供商進行交付。在選擇物流服務提供商時，我們通常會考慮其專長及專業資格、價格、聲譽、運輸效率、運輸能力及其往績記錄。我們亦要求物流提供商持有開展其業務所需的運輸許可證及其他相關資格，以及法律規定的其他資格。我們通常與物流服務提供商訂立長期協議。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未遭遇任何對我們的業務營運造成重大影響的嚴重交付延誤。

質量控制

我們於營運的各個方面均強調質量控制，涵蓋工藝、客戶及業務。從產品開發、材料採購到銷售及交貨，我們嚴格控制產品質量，以確保產品符合我們嚴格的內部標準以及國際及行業標準。我們已通過ISO 9001及ISO 14001認證。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們從未遭遇任何與產品質量有關的重大處罰或任何重大產品質量糾紛。

保修及售後服務

我們為產品提供符合行業標準的保修，保修期通常介乎一至三年，視乎產品類別、客戶要求及銷售渠道而定。我們的保修範圍涵蓋不符合我們所發佈或與客戶書面協定的規格的瑕疵產品或無效產品。

我們通過現場應用工程(FAE)團隊提供全面的售後支持，協助客戶進行產品應用及開發。就汽車客戶而言，我們可於需要時提供詳細的退貨授權分析報告。

業 務

就直銷而言，我們直接與客戶對接售後服務，確保及時有效地解決所報告的問題。就經銷商銷售而言，我們要求按標準化流程將間接客戶所報告的任何售後問題記錄於我們的系統。隨後，我們與經銷商協調或直接與客戶溝通，以解決問題並追蹤進展情況，從而維持優質服務。

我們接受瑕疵產品的退貨。我們認為，我們的退貨政策符合規管產品質量及消費者權益的中國相關法律法規（如適用）。於往績記錄期間，我們並未收到任何個別或合計對我們的業務及財務狀況造成重大不利影響的退貨請求。此外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未遭遇任何對我們的聲譽、業務營運或財務狀況造成重大不利影響的產品召回。

知識產權

截至2026年3月31日，我們有812項專利、152項註冊商標、187項版權及16個域名。請參閱「附錄六－法定及一般資料－有關業務的進一步資料－知識產權」。該等知識產權涵蓋了我們的生產流程以及產品設計。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，據我們所深知，我們並未面臨任何可能會對我們的業務或營運造成重大不利影響的重大知識產權申索。

環境、社會及管治

概覽

我們意識到環境、社會及管治因素正成為衡量企業可持續發展能力和長期價值創造的重要維度。我們在遵守A股市場監管機構ESG相關信息披露要求的同時，將於H股[編纂]後兼顧遵守香港上市規則附錄C2的要求，每年發佈ESG報告，及時、準確地向利益相關方披露我們在ESG領域的實踐與績效成果。

風險管理和內部控制

鑒於我們的業務性質，本集團目前並無產生重大排放物或廢棄物，亦無導致嚴重污染，從而從根本上減少環境ESG風險的直接影響。然而，我們仍積極分析ESG風險的多維度影響：在業務方面，我們開發低功耗芯片並通過產品創新積極佈局ESG合規領域，以順應國家綠色發展趨勢；戰略上，我們已成立戰略與ESG委員會，以研究ESG相關事宜及提出建議，並在戰略層面系統性地推進ESG管理；財務方面，通過貫徹落實ESG規定，我們已減少碳排放及能耗，同時降低能耗相關平均人工成本，持續優化營運開支；此外，我們已積極遵守監管準則，制定ESG報告及披露制度框架，以應對未來合規成本及風險，從而支持本公司的長期穩定發展。

業 務

我們積極識別ESG風險及機遇，持續專注於減少能耗、保護環境及緩解氣候變化對我們業務、戰略及財務的潛在影響。例如，我們已推出充電站服務，以方便僱員使用新能源汽車；我們已於辦公空間配置垃圾分類箱，以提高日常營運中的環保意識。

指標及目標

溫室氣體排放管理

為實現國家「雙碳」目標，我們不斷完善碳排放管理，避免碳排放違規風險，積極實施碳排放數據核算，為後續溫室氣體統計和減排工作打下堅實基礎。為保持與國際主流標準接軌，我們按照《溫室氣體核算體系》中《企業核算與報告標準》和《企業價值鏈（範圍三）核算與報告標準》的要求，持續完善碳排放內部數據盤查，夯實節能降碳數據基礎。

我們的溫室氣體排放指標明細如下：

指標	單位	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
		2023年	2024年	2025年	2026年
範圍1溫室氣體排放量.....	噸二氧化碳當量	238.6	205.3	189.6	84.9
範圍2溫室氣體排放量.....	噸二氧化碳當量	2,907.3	3,306.0	3,561.5	854.4
範圍3溫室氣體排放量.....	噸二氧化碳當量	1,436.0	1,543.0	1,702.0	453.9
溫室氣體排放總量.....	噸二氧化碳當量	4,582.0	5,054.3	5,453.0	1,393.3
每單位收入溫室氣體 排放總量.....	噸二氧化碳 當量／ 人民幣百萬元	1.0	1.2	1.2	0.9
每單位收入溫室氣體排放 總量同比變動	%	45.1	18.3	(4.6)	(22.3)

範圍1排放主要來自我們運營中的直接溫室氣體排放，包含燃油、天然氣和逸散性氣體排放。範圍2排放主要來自我們辦公場所外購電力消耗的間接溫室氣體排放。

我們逐步將溫室氣體排放數據的統計及核算工作擴展至範圍3的維度，涵蓋：類別3：與燃料和能源相關活動（不包括在範圍1或範圍2排放計算中的）、類別6：商務旅行、類別13：下游租賃資產所產生的排放。未來，我們計劃進一步擴大範圍3溫室氣體排放的統計及核算範圍，以便更好地進行溫室氣體排放的控制及相關信息披露。

自2023年至2025年，範圍2溫室氣體排放增加乃主要歸因於公司生產及經營活動的電力消耗增長。採購的電力消耗由5,418.08兆瓦時增至6,637.08兆瓦時，推動了範圍2溫室氣體排放的相應增加。範圍3溫室氣體排放增加乃主要由於因深化海外業務佈局令僱員差旅增加，從而導致範圍3溫室氣體排放同比增加。

業 務

能源管理

我們秉持「雙碳」戰略導向，將綠色發展嵌入能源管理中，積極響應聯合國可持續發展目標(SDG)及「3060雙碳目標」，持續推動在其自身營運及供應商產品生產過程中應用可再生能源。同時，我們將繼續優化日常管理，積極跟進新技術，持續提升電力運營效率，減少能源浪費並節約能源成本。

在日常運營過程中，我們主要消耗的能源包括外購電力，以及運營車輛所使用的汽油。我們嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》等相關法律法規、規章政策和行業標準，並將持續推進能源結構優化升級，提高能源使用效率。

我們的能源消耗明細如下：

指標	單位	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
		2023年	2024年	2025年	2026年
耗電總量	兆瓦時	5,418.1	6,161.0	6,637.1	1,592.3
每單位收入耗電總量	兆瓦時／ 人民幣百萬元	1.2	1.5	1.4	1.0
每單位收入耗電總量 同比變動	%	32.5	22.3	(4.3)	(27.1)
汽油消耗量	升	6,483.6	6,980.6	6,116.5	1,302.8
每單位收入汽油消耗量	升／ 人民幣百萬元	1.4	1.7	1.3	0.8
每單位收入汽油消耗量 同比變動	%	11.2	15.8	(22.1)	(35.3)
天然氣消耗量	立方米	83,562.6	60,410.4	54,066.1	31,126.0
每單位收入天然氣 消耗量	立方米／ 人民幣百萬元	18.4	14.3	11.4	20.0
每單位收入天然氣消耗量 同比變動	%	32.7	(22.2)	(20.5)	75.0

水資源管理

我們高度重視水資源管理工作，嚴格遵循《中華人民共和國水法》等相關法律法規和管理規定，積極響應國家節水政策，通過張貼節水標語等方式提高員工節水意識，把節水措施納入日常工作之中，確保我們的可持續發展，為保護水資源貢獻力量。

業 務

我們的耗水量明細如下：

指標	單位	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
		2023年	2024年	2025年	2026年
耗水總量	噸	13,878.9	15,352.9	21,654.1	4,661.5
每單位收入耗水總量	噸／ 人民幣百萬元	3.1	3.6	4.6	3.0
每單位收入耗水總量 同比變動	%	(47.2)	19.0	25.3	(34.6)

廢棄物管理

我們的廢棄物主要包括廚餘垃圾，且我們並無產生或排放工業廢水、有害廢棄物。我們嚴格遵守《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢棄物污染環境防治法》及其他運營所在地適用的相關法律法規。我們的廚餘垃圾由符合資格的第三方回收。

我們的廢棄物產生明細如下：

指標	單位	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
		2023年	2024年	2025年	2026年
無害廢棄物數量	噸	48.4	79.0	91.1	15.9
有害廢棄物數量	噸	—	—	—	—
廢棄物總量	噸	48.4	79.0	91.1	15.9
每單位收入廢棄物總量	噸／ 人民幣百萬元	0.0	0.0	0.0	0.0
每單位收入廢棄物 總量同比變動	%	66.4	75.6	2.4	(47.0)

氣候變化

我們將應對氣候變化作為企業可持續發展的責任，積極識別及應對氣候風險，同時把握低碳轉型中的發展機遇，為未來進一步深化氣候管理工作奠定基礎。

實體風險：我們將加強對極端天氣的監測與預警，強化應對措施，定期舉行緊急演習，並提供培訓以提升安全意識與應變準備。

轉型風險：我們面臨的風險來自更嚴格碳排放法規、對綠色技術和產品創新的需求以及低碳原材料與能源成本可能上升。我們支持國家「雙碳」目標，推行綠色低碳戰略，並推廣氣候規劃、低碳管理與節能升級措施管理該等風險。

業 務

氣候相關機遇：在應對氣候挑戰的過程中，我們也意識到並積極尋求在資源效率優化及綠色產品創新帶來的發展機遇。例如，購置分佈式光伏設備，短期可能導致成本增加，但能源成本隨綠電替代逐步降低，長期來看將有助於降低運營成本，增強產品市場競爭力，聚焦綠色產品研發既能打開新的業務增長空間，又能通過提升產品的低能耗特性與氣候適應性，實現可持續發展與商業價值的協同增長。

為量化氣候行動成效，我們計劃在未來逐步梳理氣候相關數據，包括易受氣候相關實體風險或轉型風險影響的資產及業務活動的數額和百分比，明確高風險領域的重點管控方向，統計與氣候機遇相關的資產及業務活動的數額及百分比，量化綠色發展舉措的投入產出效益，通過數據引領的管理模式，持續提升氣候風險管理水平，推動企業向低碳可持續方向高質量發展。

職業健康與安全

我們嚴格遵循《中華人民共和國職業病防治法》及《職業健康安全管理體系要求及適用指南》等的相關規定，始終將員工職業健康與安全放在首位，營造並維護一個安全、可靠且舒適的工作環境，致力於經濟發展的同時保障員工福祉。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無發生對我們的業務營運屬重大的嚴重職業健康事故、人身傷害或財產損害申索或向僱員支付賠償。

反腐敗與反賄賂

我們始終將誠信經營與商業道德視為核心準則，致力於打造清正廉潔、公平誠信的文化，以系統性舉措築牢廉潔防線。截至最後實際可行日期，我們已建立多渠道舉報平台。

數據隱私與網絡安全

我們收集並儲存在業務營運過程中產生或與業務營運有關的業務、管理及傳輸數據，包括有關我們與客戶、供應商及其他相關方的業務及交易的數據。我們僅在非常有限及必要的情況下收集客戶的個人資料。

為促進ISSI及Lumissil品牌的業務運營及統一管理，客戶聯絡資料、業務合作夥伴聯絡資料及相關交易數據，以及在中國境內ISSI及Lumissil實體所收集的員工數據，均透過海外開發的管理信息系統處理，並儲存於中國境外。客戶關係及訂單管理以及員工管理系統位於美國，而業務營運系統(ERP)則位於新加坡。據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期期間，有關數據境外存儲符合適用法律法規，原因是：1) 根據《促進和規範數據跨境流動規定》(「該規定」)，有關數據境外存儲不適用於獲得互聯網信息辦公室事先批准規定或向其備案；因為：i) 境外存儲的數據未被任何主管機構通知或被公開發佈為重要數據；ii) 僱員境外存儲的數據被認為對進行本集團跨境人力資源管理屬必要，符合該規定第五條第二款訂明的豁免

業 務

情況；iii) 客戶及業務夥伴的境外存儲數據，不涉及敏感個人信息且自2026年1月1日起涉及人數累計不超過100,000人。符合該規定第五條第四款訂明的豁免情況；2) 本集團已採取必要措施確保有關境外數據存儲合規，包括：於ISSI及Lumissil官網之隱私政策中披露境外個人資料儲存這一事實、向相關僱員提供專屬之境外存儲個人資料告知函、提供個人資料時取得網站使用者單獨同意，並依據適用法律法規採取措施確保獲得其他法律依據。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團並無發生任何重大數據洩漏事件。

我們已建立一個全面的數據合規系統。我們已部署十餘種類型的安全系統及政策，包括防火牆、互聯網行為管理、防病毒軟件、網絡訪問控制、數據丟失防護、威脅情報平台、日誌管理及漏洞掃描。該等工具形成了一個分層防禦系統，由網絡外圍延伸至數據中心。我們的信息技術部門負責制定及實施有關網絡安全及數據安全的政策及程序。

我們已建立系統化的政策框架，涵蓋數據分類分級指引、明確數據處理活動全週期等要求的數據安全管理政策、數據安全事故應急計劃，以及針對個人資料保護、數據跨境傳輸合規管理及員工檔案管理等專項合規政策。我們亦制定信息安全與計算機管理政策，要求定期實施網絡安全方案及稽核，以強化網絡安全管理與風險防禦能力。我們致力持續優化該等政策的執行，並通過密切關注監管動態，及時更新相關政策。

我們涉及客戶數據處理的客戶關係管理信息系統，已通過中國分級保護制度的三級評估。ISSI及Lumissil實體所使用的信息系統已於2025年接受全面信息技術審計，未發現重大安全問題。我們將持續關注數據保護及網絡安全的立法及法規發展，並及時實施所有必要措施，確保持續合規。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團未曾因中國境內數據隱私及網絡安全事宜而受到任何主管政府部門處以任何重大罰款或制裁。據我們的中國法律顧問告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團在所有重大方面均遵守現行中國數據隱私及網絡安全法律法規。

競爭

我們經營所在市場競爭激烈，且我們與其他芯片提供商競爭。競爭格局由多種因素形成，包括客戶及其各自行業的發展、技術進步、新材料或技術的出現、產能、監管變動及整體經濟狀況。可能會出現新的市場參與者，推出對現有參與者構成挑戰的創新性或具成本效益的產品。倘我們未能緊跟有關進步或未能在質量或成本方面使我們的產品脫穎而出，則我們面臨市場份額流失至競爭對手的風險。請參閱「行業概覽」及「風險因素－與我們的業務及行業相關的風險－我們面臨競爭且預期未來繼續面臨

業 務

競爭。倘我們無法有效參與競爭，我們的業務、前景、經營業績及財務狀況將受到重大不利影響」。

保險

我們持有涵蓋產品責任、一般責任及產品召回的保單。此外，我們已購買一系列財產相關保單，涵蓋我們的設施、機器、設備、存貨及其他資產。我們不時審視我們的保單，以評估覆蓋範圍的充足性及廣度。我們認為，我們的現有保險覆蓋範圍對我們業務營運而言屬充足，且符合我們營運所在國家的行業標準。儘管如此，我們可能面臨超出我們保險覆蓋範圍的申索與責任。請參閱「風險因素－與我們的業務及行業相關的風險－我們的保險範圍可能不足以覆蓋所有潛在損失」。

於往績記錄期間，我們並無作出且概無面臨任何對我們的業務或財務狀況而言屬重大的保險申索。

集團內公司間交易

於日常業務過程中，我們在不同司法權區的實體之間進行若干集團內公司間交易。下表列示所示年度／期間我們的集團內公司間交易的金額及安排。

交易類型	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
	(人民幣千元)			
晶圓及芯片.....	2,034,627	1,949,112	2,487,327	674,267
研發支持服務.....	98,318	52,311	64,372	2,430
營銷支持服務.....	106,436	73,778	89,288	16,437
知識產權轉讓.....	—	14,939	—	—
集團內公司間貸款.....	1,153,975	1,187,240	1,402,741	1,402,439

於往績記錄期間，我們的製造實體向集團內其他實體銷售晶圓及芯片並收取相應款項，而我們的研發實體則向集團內其他實體提供研發支持服務。此外，履行銷售職能的實體向其他實體提供營銷支持服務，且本集團內亦存在知識產權轉讓。本集團內亦存在融資交易。

我們已委聘獨立轉讓定價顧問，審閱於往績記錄期間的主要集團內公司間交易，重點關注重大且經常性交易。顧問已審閱我們提供的資料（包括財務數據及相關集團實體實施的業務活動），並執行基準研究。顧問通過應用主要採用四分位距法的適當轉讓定價方法，評估相關轉讓定價交易及安排的合理性。目的為評估集團內公司間交易的相關定價是否符合公平交易原則，且是否不會導致重大稅務風險。

業 務

我們的集團內公司間交易乃按市場化基準進行，以支持我們的戰略佈局、優化資源分配及遵守相關行業政策。

Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc被定為從事交易活動，且不從事生產。其台灣分公司Integrated Silicon Solution (Cayman), Inc. Taiwan Branch作為我們在台灣的生產協調中心，與上游晶圓廠及封測代工合作夥伴溝通管理製造及後端流程。

芯成積體電路（香港）有限公司同樣旨在進行交易活動，以促進海外業務。在若干國家或地區，地方政策限制與於中國註冊成立的實體直接交易；為支持該等市場的業務發展，我們的香港實體擔任訂約方。我們的香港芯片業務在以下三種主要模式下經營：(i)購買半成品、安排封測代工加工及銷售製成品；(ii)購買製成品供日後銷售；及(iii)直接向晶圓廠及封測代工合作夥伴下達生產訂單及直接向客戶銷售所產生的產品。

我們在前述實體及其他集團公司中進行集團內公司間交易，以令採購、生產及銷售流符合司法權區規定及提升商業效益。所有有關交易乃於一般業務過程中按公平條款進行。

根據我們的獨立轉讓定價顧問的資料，於往績記錄期間，我們因集團內公司間交易產生的轉讓定價風險相對較低，且我們在全球範圍內針對集團內公司間交易的轉讓定價操作並無任何重大合規問題。

獨立轉讓定價顧問已審閱下列轉讓定價交易及安排，分析結果概述如下。

(1) 製造實體向關聯方銷售晶圓及芯片的分析

於往績記錄期間，若干製造實體（包括北京君正、合肥君正科技及絡明芯微電子（香港））向關聯方銷售晶圓及芯片。該等交易的定價乃參考產品類型、應用領域、現行市場狀況及成本結構，並加上合理利潤加成而釐定。

獨立轉讓定價顧問已審閱該等交易，並發現該等銷售的毛利率大多處於基於可比基準的四分位距內。因此，該等交易的定價被視為符合公平交易原則。

(2) 集團實體間提供研發支持服務的分析

於往績記錄期間，若干履行研發職能的實體（包括ISSI美國、絡明芯微電子（廈門）、芯成半導體（上海）及絡明芯微電子（武漢））根據服務外包安排向關聯方提供研發支持服務。該等交易的服務費乃按所產生實際成本加計合理利潤加成計算。

獨立轉讓定價顧問已審閱該等交易的定價，並發現該等服務安排的毛利率大多處於基於可比基準的四分位距內。因此，該等交易的定價被視為符合公平交易原則。

業 務

(3) 集團實體間提供營銷支持服務的分析

於往績記錄期間，若干履行銷售職能的實體（包括ISSI美國、芯成半導體（上海）、矽成積體電路、ISSI日本、ISSI香港、ISSI新加坡、ISSI韓國、絡明芯微電子（廈門）、絡明芯微電子（武漢）、ISSI-Cayman台灣分公司、ISSI以色列、Integrated Silicon Solution (Beijing)及深圳君正時代），向關聯方提供營銷、銷售、市場研究及營運支持服務。

獨立轉讓定價顧問已審閱該等交易的定價，並發現該等服務安排的毛利率處於基於可比基準的四分位距內。因此，該等交易的定價被視為符合公平交易原則。

(4) 知識產權轉讓的分析

於往績記錄期間，ISSI曾一次性將特定知識產權轉讓予絡明芯微電子（廈門）。該交易價格乃根據專業評估公司進行的估值釐定，該估值綜合採用市場法與收益法，並計及十年盈虧預測及可比上市公司市場表現，從而得出合理價值。

獨立轉讓定價顧問已審閱此項交易的定價，並認為轉讓價格符合公平交易原則。

(5) 集團內公司間融資安排的分析

於往績記錄期間，本集團內若干實體（包括ISSI、芯成半導體（上海）、絡明芯微電子（廈門）、Integrated Silicon Solution (Beijing)、上海閃勝集成電路、北京君正及深圳君正時代）為日常營運需求及策略性融資目的而訂立公司間貸款安排。

獨立轉讓定價顧問已審閱該等融資安排，並發現多數貸款均計息且定價符合市場利率。少數貸款以免息或低息形式提供，旨在支援財務實力較弱的聯屬公司，該等安排並非基於避稅動機。因此，該等交易的定價整體被視為符合公平交易原則。

基於上述分析，獨立轉讓定價顧問認為，於往績記錄期間，轉讓定價交易及安排整體符合公平交易原則，且我們全球的轉讓定價做法並無任何重大合規性問題。

儘管我們無法保證中國大陸、香港及其他司法權區的稅務機關不會根據相關法律法規作出任何轉讓定價調整，董事（經諮詢我們的獨立轉讓定價顧問後）認為，本集團對於其於往績記錄期間的轉讓定價安排可能面臨的質疑，將有合理抗辯理據。

業 務

為確保持續符合適用轉讓定價法律法規，我們已採取或正在採取下列措施：

- 我們將每年委聘外部稅務顧問處理轉讓定價事宜，對我們所選定的轉讓定價方法及利潤水平指標進行分析，並根據分析結果透過財務預算規劃相關交易的轉讓定價政策；
- 我們將監察稅務相關事項的內部控制政策實施情況，包括確保集團內公司間交易已妥善記錄、存檔及保存以供查核，從而避免於向相關稅務機關申報前出現任何不一致之處；
- 所有公司間協議將由各實體的財務經理進行審閱，以適時諮詢本公司律師及當地會計師，就價格設定是否符合轉讓定價規定提出意見。財務經理將持續監察集團內公司間交易，並向財務總監匯報，以確保符合公平交易原則；
- 財務經理將審閱所有申報表格後提交予相關稅務機關；
- 實體的財務經理將為風險管理目的，編製並提交各實體價值貢獻的相關支持文件，包括但不限於職責規劃、往來函件、相關工作的績效與成果評估等，並將該等資料提交予我們的財務總監審閱；及
- 我們將安排財務總監與各實體財務主管舉行專題會議，以審閱並分析集團內公司間交易、轉讓定價結果，評估相關內部控制及合規流程的有效性，討論稅務規劃及合規事宜，並確保定價政策符合適用監管要求。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團並無就集團內公司間交易或轉讓定價安排受到中國或任何其他司法權區稅務機關的任何未決查詢、審計、調查或質疑。

物業

截至2026年3月31日，我們在中國大陸擁有27項物業及租賃8項主要物業。截至同日，我們在海外（包括香港特別行政區、美國、日本及以色列通過兩處主要自有物業及三處主要租賃物業經營業務。我們主要將自有物業及租賃物業用作我們的辦公場所。

截至2026年3月31日，我們並無單一物業的賬面值佔我們總資產的15%或以上，因此，我們無需根據上市規則第5.01A條於本文件載入任何估值報告。根據《公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第6(2)條，本文件豁免遵從公司（清盤及雜

業 務

項條文) 條例第342(1)(b)條有關公司(清盤及雜項條文) 條例附表3第34(2)段的規定，當中規定須提供有關我們於土地或建築物的所有權益的估值報告。

自有物業

截至2026年3月31日，我們在中國大陸擁有27項物業，總建築面積為59,761.3平方米。我們主要將該等物業用作我們的辦公場所。截至同日，我們在中國擁有六項土地使用權，總佔地面積為260,837.7平方米(其中227,887.03平方米為共同擁有的土地面積)。

租賃物業

截至2026年3月31日，我們在中國大陸租賃八項主要物業，總建築面積為4,316.6平方米，主要用作我們的辦公場所。有關我們租賃物業的合規事宜，請參閱「風險因素一日後未能完成租賃協議備案可能會面臨處罰」。

僱員

截至2026年3月31日，我們有1,251名全職僱員，約70.7%的僱員位於中國大陸。下表載列截至2026年3月31日按職能劃分的全職僱員明細。

職能	2026年3月31日	
	人數	%
銷售人員	167	13.3
研發人員	822	65.7
財務人員	54	4.3
營運人員	88	7.0
IT人員	31	2.5
人力資源人員	20	1.6
行政人員	27	2.2
其他	42	3.4
總計	1,251	100.0

下表載列截至2026年3月31日按地理位置劃分的全職僱員明細。

地理位置	截至2026年3月31日	
	人數	%
中國大陸	885	70.7
海外 ⁽¹⁾	366	29.3
總計	1,251	100.0

附註：

(1) 主要包括美國、日本及以色列。

業 務

我們為僱員提供若干福利，包括社會保險保障及其他僱員福利。我們與僱員訂立個人僱傭合約，涵蓋薪資、僱員福利、保密性及終止理由等事項。我們的僱員薪酬乃根據其工作職位、技術能力、工作表現及競爭力而釐定。

我們已制定一系列適配我們的戰略方向及人才培養目標的綜合培訓項目。概無僱員為工會代表或參與集體談判協議。我們認為，我們與僱員維持良好的僱傭關係。於往績記錄期間，我們並未遭遇任何對我們的業務及營運造成重大不利影響的罷工、停工、勞資糾紛或其他行動。

牌照、許可及批文

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已自相關政府部門取得對我們的業務營運而言屬重要的一切必要牌照、許可、批文及認證。我們持續監控對該等規定的遵守情況，以確保我們擁有經營業務所必需的有關批文、牌照及許可。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在重續重要牌照、許可或批文方面並無遭遇任何重大困難，且預計在其到期重續方面將不會遭遇任何重大困難。

下表載列我們的主要牌照、批文及許可。截至最後實際可行日期，以下牌照及許可均有效。

持有人	牌照、批文及許可的名稱
本公司	高新技術企業證書
本公司	進出口貨物報關單收據

法律訴訟

在日常業務過程中我們可能不時捲入各項法律、仲裁或行政訴訟。請參閱「風險因素－我們可能不時捲入訴訟、仲裁、其他法律及合同糾紛、索賠及行政訴訟」。截至最後實際可行日期，概無針對我們或我們任何董事的未決或即將提起的可能會對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的訴訟、仲裁或行政訴訟。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無預計將對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的嚴重違反或違反我們所適用法律法規的情況。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遭遇任何不合規事件，而董事認為該等事件（不論個別或整體而言）可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。

於往績記錄期間，我們若干中國附屬公司並無為有限數目的僱員作出充足住房公積金供款。就本集團未能作出全額住房公積金供款，本集團已全部糾正有關不合規行

業 務

為。截至最後實際可行日期，本集團已為相關僱員補足於往績記錄期間的住房公積金供款的所有未支付差額。

於往績記錄期間，我們聘請第三方人力資源機構為若干僱員繳納社會保險及住房公積金。根據適用的中國法律法規，該等繳納通常須由用人單位透過其自身賬戶進行。使用第三方機構進行該等付款可能未完全符合適用的監管要求。請參閱「風險因素－我們委聘第三方人力資源機構繳納社會保險費及住房公積金」。

根據我們中國法律顧問的意見：(i)根據《住房公積金管理條例》，(a)倘我們未能在規定期限前為僱員辦理住房公積金登記或設立住房公積金賬戶，我們可能會被處以每家違規附屬公司或分公司人民幣1萬元以上人民幣5萬元以下的罰款；及(b)倘我們未能在規定期限內繳納住房公積金，則可能會被申請法院強制執行；及(ii)根據《中華人民共和國社會保險法》，(a)倘我們未能按時足額繳納社會保險費，相關中國主管機關可能會要求我們在規定期限內繳足，且我們可能須按日加收相當於欠繳數額萬分之五的滯納金；及(b)倘我們未能於規定期限內補繳，我們可能會被處以欠繳數額一倍以上三倍以下的罰款。我們已獲得相關主管機關就本集團中國成員公司發出的確認函，確認除新設立的實體或無僱員的實體外（如適用），於往績記錄期間內並無因違反相關法律法規而遭受相關主管機關處罰的記錄。由於金額並不重大，故未在財務報表中計提撥備。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，未能悉數供款的住房公積金供款的差額分別為人民幣3,262元、人民幣7,056元及人民幣4,200元，而截至2026年3月31日止三個月為零。根據《住房公積金管理條例》，單位不辦理住房公積金繳存登記或者不為本單位職工辦理住房公積金賬戶設立手續的，由住房公積金管理中心責令限期辦理；逾期不辦理的，處人民幣1萬元以上人民幣5萬元以下的罰款。由於有關不合規僅涉及住房公積金供款，且僅涉及一個實體，就此對本集團可能施加的最高罰款為人民幣50,000元。截至最後實際可行日期，本集團已完全糾正有關不合規行為。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，通過有關第三方代理安排作出的社會保險供款金額分別約為人民幣2.3百萬元、人民幣1.0百萬元、人民幣1.0百萬元及人民幣0.3百萬元。同期通過有關安排作出的住房公積金供款金額分別約為人民幣1.6百萬元、人民幣0.6百萬元、人民幣0.6百萬元及人民幣0.2百萬元。利用第三方代理作出社會保險供款或住房公積金供款可能被視為未能按時足額繳付。就社會保險，根據《中國社會保險法》，用人單位未按時足額繳納社會保險費的，由社會保險費徵收機構責令其限期繳納或者補足，並自欠繳之日起，按日加收萬分之五的滯納金；逾期仍不繳納的，由有關行政部門處欠繳數額一倍以上三倍以下的罰款。根據最高罰款金額為逾期金額的三倍，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年3月31日止三個月，就通過第三方代理安排作出

業 務

的社會保險供款可能對本集團施加的最高罰款分別約為人民幣7.0百萬元、人民幣3.1百萬元、人民幣3.0百萬元及人民幣0.8百萬元。就住房公積金，根據《住房公積金管理條例》，就相關不合規行為可能施加的罰款不低於人民幣10,000元及不超過人民幣50,000元。由於有關安排涉及本集團內部兩個實體，故就此可能對本集團施加的最高罰款為人民幣100,000元。

鑒於各相關地區通過第三方代理安排為其作出供款的僱員數目相對較小，且所涉及的僱員總數有限，本集團承諾，如相關監管機構或其僱員要求，其將及時糾正有關安排。

此外，於2025年7月31日，中國最高人民法院頒佈《最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》（「新司法解釋」），自2025年9月1日起生效。根據新司法解釋第19(1)條，用人單位與勞動者約定或者勞動者承諾無需繳納社會保險費的，人民法院應當認定該約定或者承諾無效。用人單位未依法繳納社會保險費，勞動者依據《中華人民共和國勞動合同法》第38(3)條的規定解除勞動合同並要求用人單位支付經濟補償的，人民法院應予支持。在此情況下，用人單位仍負有向勞動者支付經濟補償（按工作年限乘以月工資計算）的義務，即使雙方此前曾約定放棄繳納社會保險費。據我們的中國法律顧問告知，新司法解釋預期不會對我們的財務狀況及業務造成重大不利影響，原因如下：(i)預期新司法解釋不會增加本集團於往績記錄期間社會保險欠繳金額所涉及的上述估計最高潛在罰款，因為因員工選擇或雙方協議而產生的欠繳金額已納入該等計算；(ii)我們並不知悉任何員工就社會保險或住房公積金繳納事宜提出任何重大或大規模投訴、異議或勞動爭議；及(iii)倘主管部門要求我們在指定期限內進行整改或繳納，或補繳社會保險欠繳金額，我們承諾積極採取相關整改措施並按要求繳納。然而，倘中國相關部門持有與我們不同的觀點，並認定我們違反新司法解釋，則本集團的財務及業務表現可能受到不利影響。

為確保日後在實際可行範圍內遵守相關法律法規項下有關社會保險及住房公積金的繳納規定，我們計劃：(i)加強內部控制政策，據此，我們的法律及人力資源部門將定期監控我們社會保險及住房公積金繳納的合規情況；(ii)加強人員培訓，包括為僱員提供各類合規相關主題的培訓；及(iii)定期了解與社會保險及住房公積金相關的中國法律法規的最新進展。

業 務

美國關稅

我們在全球供應鏈內經營，且我們的產品作為各類終端產品的一部分在全球銷售。因此，我們面臨與國際貿易法規及地緣政治發展相關的風險。

近期中美貿易爭端導致關稅高企、出口管制及其他針對高科技商品、半導體及電子產品的限制性措施。我們的產品分類為美國協調關稅表稅目**8542**，原因是該稅目明確說明其適用於「電子集成電路」，該表述所指恰為我們所售產品。於往績記錄期間，產自中國的該等產品通常須繳納**50%**的美國關稅另加中國與美國於**2025年10月30日**達成的貿易協議項下所謂**10%**的「芬太尼」關稅。於**2026年7月24日**，美國總統對許多中國產品徵收**12.5%**關稅，但**2026年7月24日**行動通知(July 24, 2026 Notice of Action)附件I.A.2第**52(b)**條及附件II.A指出該新關稅不適用於稅目**8542**物項，因此，本公司的產品無須繳納該關稅。因此，我們從中國大陸售往美國的產品適用的最新實際關稅稅率為**60%**。我們的產品可能會被集成到各類終端產品並由美國進口，而關稅(如有)將由進口方承擔。進口該等產品的公司可能希望將額外的關稅轉嫁給我們。即使關稅並無轉嫁給我們，客戶終端產品競爭力的下降可能導致其減少或取消向我們下達的採購訂單。本公司無法獲取其客戶的銷售數據，但本公司基於其與客戶就他們的目標市場、他們向本公司訂購產品的模式作出的討論及本公司收到的產品支持地域分佈查詢認為，本公司向將本公司元件集成到其產品並售往美國的客戶銷售所得收入僅佔本公司於往績記錄期間總收入的極小比例。

我們認為於往績記錄期間上述關稅制度並無對我們的運營或財務表現造成重大不利影響。我們於中國大陸及香港的附屬公司所作之對美銷售，須繳納上述美國關稅，原因為通過相關銷售出售的產品主要由位於中國大陸的晶圓廠生產，故須繳納該等關稅。於往績記錄期間各期間，該等銷售佔我們總收入不足**2%**。我們亦獲益於通過我們於中國大陸以外的附屬公司(如美國及台灣地區的附屬公司)的結構性多元化運營。通過該等附屬公司所作之對美銷售無須繳納上述美國關稅，原因為通過相關銷售出售的產品乃由位於台灣地區或中國大陸以外的其他地區的晶圓代工廠生產。我們計劃通過多元化製造及物流佈局、進行選擇性價格調整及加強與經銷商的接洽以於必要時重新設計物料清單，以降低關稅風險，從而緩解潛在影響。

此外，我們的芯片乃作為組件，由下游客戶嵌入汽車、工業醫療以及消費領域的各類終端產品，包括汽車電子系統、工業控制及醫療設備以及消費電子設備。倘該等終端產品出口至美國，則可能因其產品類別及原產地而須繳納美國關稅。即使美國關稅適用於我們的下游客戶內置我們的芯片的終端產品(於該等終端產品出口至美國時)，我們認為，該等關稅對我們的業務營運及財務表現造成的任何間接影響目前並不重大，預期日後亦不會構成重大影響，主要原因如下：(i)該等關稅由下游客戶承擔，而非由我們承擔，且於往績記錄期間，並無任何下游客戶要求我們承擔其內置我們芯片的終端產品所涉及關稅；及(ii)我們的芯片僅佔下游客戶終端產品總價值的一小部分，因此，即使下游客戶受該等關稅影響，我們的芯片對該等客戶所構成的成本影響

業 務

不重大。鑒於我們的產品的下游應用及終端市場多元化以及客戶基礎多元化，我們認為，對我們的業務營運及財務表現的任何有關間接影響目前並不重大，預期亦不會構成重大影響。

制裁及出口管制

《出口管理條例》(「**EAR**」)對美國民用產品(例如我們的產品)出口進行規管，而美國商務部工業與安全局(「**BIS**」)負責實施**EAR**。請參閱「監管概覽－美國法律法規－與美國出口管制及制裁有關的法律及法規」。

根據**EAR**，非美國生產的物品若包含或捆綁價值達某一比例的美國原產受管制物品，或在生產過程中使用某些美國受管制的軟件或技術或位於美國，即受**EAR**規限。

BIS亦存置受強化出口管制限制規限的個人及實體清單。**BIS**實體清單包括數百家中國實體，該等實體在出口、再出口或轉讓若干受**EAR**規限的產品與技術時須遵守特定許可要求。

EAR適用於「受**EAR**規限」的所有物項(如商品、軟件及技術)，不僅包括美國製造的物項或實際位於美國的物項，亦包括特定外國製造商品。非美國製造的物項如符合「直接產品」規則或超過「最低」受管制美國含量，則受**EAR**規限。此外，根據**EAR**，相關限制取決於腳註標註是否適用，如適用，則取決於適用哪個腳註。我們於往績記錄期間與實體清單上的供應商開展的任何交易僅涉及腳註5標註或並無腳註標註。腳註5指我們不得交付用於設計或製造集成電路「生產設備」的物項。

於往績記錄期間，我們的常規晶圓代工安排包括採購實體清單上的晶圓廠所製造的晶圓。有關採購涉及我們接收如此製造的晶圓，而非向實體清單上的晶圓廠出口、再出口或轉讓任何受**EAR**所規限的物項或任何用於設計或製造集成電路「生產設備」的物項。就任何有關交易，我們僅交付用於集成電路的設計文件，並無交付任何用於設計或製造任何生產設備的物項。我們亦不得向實體清單上的任何實體交付受**EAR**所規限的物項，且於往績記錄期間，我們並未向實體清單上的任何實體交付受**EAR**所規限的任何物項。

我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問已確認，根據適用於我們的相關制裁法律及法規，我們採購實體清單上的晶圓廠所製造的晶圓本身不會造成任何制裁風險。我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問亦已確認，本集團並無因其與實體清單上的供應商的交易而面臨任何重大制裁風險，包括有關轉讓設計文件及採購上述晶圓的交易。我們向實體清單上的晶圓廠作出的設計文件轉讓並不涉及

業 務

EAR，原因如下：(i)我們向有關晶圓廠交付的設計文件並非從美國交付；(ii)我們並無在有關晶圓廠獲納入實體清單後向其轉讓受EAR規限的任何物項；及(iii)就腳註5而言，無論如何，設計文件不構成集成電路「生產設備」。

作為中國半導體行業的一家無晶圓廠公司，完全避免與實體清單上的中國晶圓廠進行交易在商業上並不可行，但我們已遵守適用於我們交易的限制。我們亦採取必要的合規措施，以履行出口管制義務，包括：

- 確認我們可能向實體清單上的公司銷售或轉讓的任何物品不受EAR的規限；
- 在日常業務中採取一切必要的合規措施；
- 必要時要求我們的客戶簽署出口管制合規承諾；
- 在與供應商及合約經銷商的合約中施加合適貿易合規義務；及
- 委聘合規團隊及技術團隊審查及評估我們成品的相關出口管制分類。

我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問美國盛智律師事務所已審查本公司與實體清單上的公司進行的交易及本公司釐定有關物品是否EAR規限的方式，並已確認本公司於往績記錄期間開展該業務的方式符合美國法律。美國法律並無禁止本公司自實體清單上的公司採購產品，且除非美國法律允許，否則本公司會注意不向有關公司提供任何物品。

我們的計算芯片可用於消費電子應用領域，包括安防攝像頭。用於安防攝像頭應用的計算芯片主要通過經銷商銷售。若干中國視頻監控攝像頭及監控技術生產商受制裁、貿易限制及政府採購禁令（統稱為「**限制措施**」）的規限。

美國、歐盟及英國政府已通過以下四種方式實施限制措施：(i)將特定個人及實體加入制裁名單（例如，美國特別指定國民名單、英國制裁名單，以及受歐盟金融制裁的個人、團體和實體綜合名單）；(ii)就美國而言，將若干實體列入EAR下的實體清單，致使受EAR管制的物項不得交付予該等實體；(iii)基於其技術特性及能力，將特定物項（包括特定芯片）指定為須受更嚴格的出口管制（具體而言，符合3A090標準的先進計算及高性能芯片，或專為用作3A981所涵蓋的大規模視頻監控設備組件而設計的芯片，或其他受3A001項下嚴格出口管制的高性能芯片）；及(iv)就美國而言，根據NDAA第889條，禁止美國政府向特定中國公司及其附屬公司採購電信或視頻監控設備。

鑒於我們的產品主要通過經銷商網絡出售，於往績記錄期間我們利用廣泛的經銷商網絡。因此，我們並無直接了解或控制各經銷商的終端客戶的完整清單，這限制了我們全面跟蹤終端客戶或絕對確定我們的任何終端客戶是否受限制措施規限的能力。

業 務

根據弗若斯特沙利文的資料，芯片設計公司主要通過經銷商銷售其產品乃屬行業常見慣例，因此無法獲得其終端客戶的完整資料。

通過實施下文所述措施，我們於往績記錄期間及直至最後實際可行日期並無發現任何情況會導致本集團面臨限制措施的風險。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無收到任何相關政府機構就向我們任何終端客戶銷售我們產品發出的任何通知、問詢或警告。我們計算芯片的經銷商確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無我們的計算芯片售予受限制措施規限的終端客戶。此外，由於我們計算芯片的出口分類並不屬於相關政府用於實施限制措施的類別，因此即使在假設任何計算芯片間接轉讓予受有關限制措施規限的終端客戶的情況下，我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問認為我們的潛在制裁風險較低。

儘管我們並無我們終端客戶的完整名單，但我們已實施以下措施管理與限制措施有關的風險：

- (i) 嚴格合約契諾及終端用途控制 — 我們與經銷商的協議載有禁止向受出口及制裁限制措施規限的客戶銷售的合約條款，且我們有權就任何違約行為向經銷商追償；
- (ii) 獨立出口分類及通用產品定位 — 我們持續聘用美國出口管制專家對我們的芯片進行分類，且我們的芯片均不屬於3A090、3A981或3A001類別。我們芯片的出口分類並不屬於美國或其他政府用以實施限制措施的分類。相反，我們的產品為通用型、大眾市場產品，應用於消費電子及一般商業場景，僅用於家用攝像頭、可視門鈴或運動相機等基本視頻應用。該等產品不具備用於大規模視頻監控所需的功能；及
- (iii) 技術跟蹤及市場監察機制 — 我們通過植入唯一標識符(UID)實施芯片級序列化，並將出貨資料與經銷商資料庫進行比對，且我們能定期進行市場抽樣調查及成品拆解分析。如集成我們的芯片的成品發生任何制裁相關風險事件，我們將可獲得相關產品、讀取當中集成芯片的UID，識別有關UID相應的生產批次，並將有關批次與我們的出貨記錄進行比較，從而將相關芯片可能經由其發貨的經銷商範圍縮小至幾家經銷商或一批分銷商。

此外，如第889條的適用範圍擴大至禁止美國政府向特定中國公司採購普通視頻監控設備，我們並無依賴任何受NDAA第889條影響的銷售。

經計及上述因素，我們認為限制措施及通過經銷商銷售對本集團造成的風險較低。

業 務

美國對外投資規則

於2024年10月28日，美國財政部發佈一項最終規則，編入《聯邦規則彙編》第31編第850部（「**最終規則**」），於2025年1月2日生效，以實施第14105號行政命令，該命令乃有關美國對「受關注國家」（包括中國大陸（及香港、澳門））的特定國家安全技術與產品的對外投資。最終規則禁止或要求美國人士對在以下三個領域從事特定「受限活動」的「受限外國人士」的若干投資進行通知：(i)半導體及微電子；(ii)量子信息技術；及(iii)人工智能系統。最終規則設有例外情況，包括針對涉及公開交易證券的交易，其中美國人士並無獲得超出標準少數股東保障的權利。

根據我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問美國盛智律師事務所的分析，倘此等收購須以購買公開交易證券形式進行，且美國人士並無獲得任何超出《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(2)條所列適用標準少數股東保障的管治或其他權利，則美國人士將能夠參與(i) [編纂]及(ii) 收購[編纂]及[編纂]後二級市場交易中的H股，而無須通知美國財政部有關投資。此結論乃基於《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(1)(i)條所載的例外情況及有關公開交易證券的交易被剔除於「受限交易」定義之外，該定義原適用範圍涵蓋特定股權收購、具特定特徵的債務融資、合營企業以及非美國集合投資基金的有限合夥人權益。

我們的法律顧問於達致該結論時，已計及美國財政部發佈的《對外投資安全計劃》常見問題（「常見問題」）。根據美國財政部於2025年12月23日發佈的常見問題第X.4條，收購受限外國人士的股權，倘相關證券於收購時屬公開交易證券，則有關收購被視為收購「公開交易證券」，並因而歸入《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(1)(i)條所述之例外情況，而不論相關認購或購買協議於何時訂立。據此，我們的法律顧問認為，於[編纂]及[編纂]完成後，美國人士在[編纂]中認購的H股，於該等收購生效時將於聯交所公開[編纂]，而該等H股將據此構成《聯邦規則彙編》第31編第850.501(a)(1)(i)條所指之「公開交易證券」。因此，美國人士於[編纂]中收購H股，屬上述例外情況，且並無導致向美國財政部的任何申報責任。基於相同理由，美國人士收購[編纂]後二級市場交易中的H股，因所收購之證券屆時已屬公開交易證券，同樣歸入上述例外情況。

若美國人士參與[編纂]或相關投資所獲權利超出標準少數股東保障（例如，可接觸重大非公開技術信息的董事會觀察員權、對技術產品線的否決權，或其他經強化管治或信息權），該參與可能構成須通知的「受限交易」。美國人士應就其具體情況諮詢自身法律顧問。

儘管最終規則對公開交易證券設有例外情況，但其可能會降低須遵守內部合規限制或尋求可能觸發通知或禁止的經強化權利的特定美國投資者的參與意願。因此，最終規則可能限制我們在[編纂]中及其後向部分美國投資者募集資金或或有股本的能力。請參閱「風險因素－我們面臨美國第14105號行政命令及其實施法規相關的風

業 務

險，該行政命令及相關條例禁止美國人士作特定投資並要求其就有關投資履行申報責任」，當中討論潛在不利影響，包括法規詮釋演變、受限行業的可能擴張及相關不確定性。

我們有關國際制裁及美國對外投資法律的法律顧問美國盛智律師事務所已告知，基於其對我們的業務活動及公開披露資料的審查，由於我們為於受關注國家組織成立且主要營業地點位於受關注國家的實體，且我們設計集成電路（就釐定實體是否為「受限外國人士」而言，設計集成電路屬於「受限活動」範疇），故我們將被視為「受限外國人士」，即使如下文所述，我們的業務不包括《聯邦規則彙編》第31編第850.224條項下投資禁令針對的任何業務活動。

我們並無直接或間接從事最終規則項下的投資禁令針對的任何業務活動。根據美國盛智律師事務所的審查，得出該結論的原因包括：

- **並無達到禁止門檻的先進節點芯片設計／製造／封裝：**我們並無設計、製造或封裝達到《聯邦規則彙編》第31編第850.224(c)、(d)或(e)條所述禁止門檻的集成電路，例如包括(i)採用非平面晶體管架構且節點在16/14nm或以下並具有特定性能特徵的邏輯芯片；(ii)滿足特定位密度或I/O性能門檻的存儲芯片；或(iii)能夠實現禁止類性能的先進封裝能力。
- **不提供禁止類支持性服務：**我們不提供晶圓代工服務、EDA工具開發、掩模寫入、先進光刻技術服務，或《聯邦規則彙編》第31編第850.224條列舉的其他會構成對先進節點芯片的禁止類支持性活動的服務。
- **商業範圍限於通用及傳統節點產品：**我們的產品均採用成熟工藝節點進行設計和製造，應用於不構成「禁止類受限活動」的商業領域。我們亦不從事量子信息技術，或開展任何符合「禁止類」標準的AI系統活動（如訓練超過特定計算門檻的前沿模型，或開發明確用於軍事／情報最終用途的AI系統）。
- **治理、數據訪問及信息控制：**我們並無授予投資者超出標準少數股東保障的技術控制權或訪問權，且我們對訪問敏感技術信息設有嚴格的內部控制限制，從而降低投資可能被認定為賦予喪失資格的權利的風險。
- **非任何美國限制清單或指定對象：**我們並非第850.224(m)條所述的任何清單或指定對象。
- **與第850.224條所涵蓋的其他人士概無任何關係：**我們與從事第850.224條所述活動的其他人士或所述清單或指定對象之間不存在第850.209(a)(2)條所述的任何關係。